

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.

蘇州納芯微電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2676)

**截至2025年12月31日止年度之
全年業績公告**

本集團的財務摘要

本集團截至2025年12月31日止年度之綜合年度業績連同截至2024年12月31日止年度之比較數字如下：

	截至12月31日止年度		變動
	2025年 人民幣千元	2024年 人民幣千元	
收入	3,367,823	1,960,274	71.8%
毛利	1,078,233	549,346	96.3%
經營虧損	(212,901)	(381,397)	-44.2%
年度虧損	(228,874)	(402,878)	-43.2%
年度全面收益總額	(228,108)	(403,627)	-43.5%
每股虧損			
- 基本及攤薄(人民幣元/股)	(1.60)	(2.86)	-44.1%

年度業績

蘇州納芯微電子股份有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司「**本集團**」董事會(「**董事會**」)欣然公佈本集團截至2025年12月31日止年度之綜合年度業績，連同截至2024年12月31日止年度的比較數字。

合併財務報表已按歷史成本基準編製，惟若干以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債及以公允價值計量的衍生金融工具除外。

財務資料

以下載列於本公告內的財務資料已由審計委員會審閱，並經董事會批准和獲本公司的境外核數師－畢馬威會計師事務所同意，本公告所載本集團截至2025年12月31日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合損益及其他全面收益表及該等相關附註的數據等同於本集團截至2025年12月31日止年度之經審計綜合財務報表所載之數額。本公司按國際財務報告準則(「**國際財務報告準則**」)會計準則編製的2025年合併財務報表亦已經過本集團境外核數師審計並由其出具標準無保留審計意見。

綜合損益表

截至2025年12月31日止年度

	附註	2025年 人民幣千元	2024年 人民幣千元
收入	4	3,367,823	1,960,274
銷售成本		<u>(2,289,590)</u>	<u>(1,410,928)</u>
毛利		<u>1,078,233</u>	<u>549,346</u>
其他淨收入		77,074	98,529
銷售及營銷開支		(260,896)	(188,942)
管理開支		(305,712)	(286,872)
研發開支		(794,603)	(539,992)
貿易及其他應收款項減值虧損		<u>(6,997)</u>	<u>(13,466)</u>
經營虧損		(212,901)	(381,397)
財務成本	5	(22,671)	(16,435)
應佔聯營公司減值虧損及撥備		<u>(5,623)</u>	<u>(6,323)</u>
除稅前虧損		(241,195)	(404,155)
所得稅	6	<u>12,321</u>	<u>1,277</u>
年內虧損		<u>(228,874)</u>	<u>(402,878)</u>
以下各項應佔：			
本公司權益股東		(228,874)	(402,878)
非控股權益		<u>-</u>	<u>-</u>
年內虧損		<u>(228,874)</u>	<u>(402,878)</u>
每股虧損			
基本及攤薄(人民幣元)	7	<u>(1.60)</u>	<u>(2.86)</u>

綜合損益及其他全面收益表

截至2025年12月31日止年度

	2025年 人民幣千元	2024年 人民幣千元
年內虧損	<u>(228,874)</u>	<u>(402,878)</u>
年內其他全面收益		
其後被或可能被重新分類至損益的項目：		
換算匯兌差額：		
– 海外附屬公司財務報表	<u>766</u>	<u>(749)</u>
年內全面收益總額	<u><u>(228,108)</u></u>	<u><u>(403,627)</u></u>
以下各項應佔：		
本公司權益股東	<u>(228,108)</u>	<u>(403,627)</u>
非控股權益	<u>–</u>	<u>–</u>
年內全面收益總額	<u><u>(228,108)</u></u>	<u><u>(403,627)</u></u>

綜合財務狀況表

於2025年12月31日

	附註	12月31日 2025年 人民幣千元	12月31日 2024年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		1,837,365	1,523,589
使用權資產		21,892	16,440
無形資產		389,174	390,732
商譽		545,470	504,142
於聯營公司的權益		111,052	96,675
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		428,971	290,129
定期存款		81,038	–
其他非流動資產		45,858	137,840
遞延稅項資產		43,102	25,876
		<u>3,503,922</u>	<u>2,985,423</u>
流動資產			
存貨及合約成本	8	1,475,940	832,556
合約資產		285	285
貿易及其他應收款項	9	995,907	646,981
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		1,124,163	2,080,083
定期存款		93,000	94,334
受限制銀行存款		22,656	20,835
現金及現金等價物		2,465,627	1,013,079
		<u>6,177,578</u>	<u>4,688,153</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	10	840,416	627,878
合約負債		33,191	16,136
計息借款	11	115,537	62,382
租賃負債		8,685	7,822
即期稅項		742	3,666
退回權利的退款負債		53,355	39,178
		<u>1,051,926</u>	<u>757,062</u>
流動資產淨值		<u>5,125,652</u>	<u>3,931,091</u>
總資產減流動負債		<u>8,629,574</u>	<u>6,916,514</u>

綜合財務狀況表(續)

於2025年12月31日

	12月31日 2025年 人民幣千元	12月31日 2024年 人民幣千元
	附註	
非流動負債		
計息借款	851,512	791,421
租賃負債	10,891	6,434
就收購附屬公司應付款項	17,489	55,037
遞延收入	40,081	31,244
遞延稅項負債	54,684	48,516
退回權利的退款負債	6,918	4,393
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	33,236	32,355
	<u>1,014,811</u>	<u>969,400</u>
淨資產	<u>7,614,763</u>	<u>5,947,114</u>
資本及儲備		
股本	161,597	142,529
庫存股份	(127,664)	(14,907)
儲備	7,563,249	5,814,722
本公司權益股東應佔權益總額	7,597,182	5,942,344
非控股權益	17,581	4,770
權益總額	<u>7,614,763</u>	<u>5,947,114</u>

合併財務報表附註

截至2025年12月31日止年度

1. 一般資料

蘇州納芯微電子股份有限公司(「本公司」)於2013年5月17日在中華人民共和國(「中國」)江蘇省蘇州市根據中國公司法成立為有限責任公司。

於2016年3月，本公司改制為股份有限公司。於2022年4月，本公司的A股於上海證券交易所科創板上市，股份代號：688052。本公司H股於2025年12月8日在香港聯合交易所有限公司主板上市。

本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事設計、研究及開發各類芯片產品。

2. 會計政策概述

2.1 合規聲明

本財務報表乃根據所有適用的國際財務報告準則編製，統稱包括由國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的所有適用的個別國際財務報告準則會計準則、國際會計準則及詮釋，以及香港公司條例的披露要求。本財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則中適用的披露規定。本集團所採納的重大會計政策於下文披露。國際會計準則理事會已頒佈若干國際財務報告準則之修訂本，該等修訂本於本集團當前會計期間首次生效或可供提前採納。

2.2 財務報告編製基礎

截至2025年12月31日止年度的綜合財務報表包括本公司及其附屬公司及本集團於一間聯營公司的權益。

編製財務報表所採用的計量基準為歷史成本基準，惟以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及負債、以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產及業務合併中承擔的或有負債按其公允價值列賬。

編製符合國際財務報告會計準則的財務報表需要管理層作出判斷、估計及假設，該等判斷、估計及假設會影響政策的應用以及資產、負債、收入及開支的呈報金額。該等估計及相關假設乃基於過往經驗及在有關情況下被認為合理的各種其他因素，其結果構成對不易從其他來源得出的資產及負債賬面值作出判斷的基礎。實際結果可能有別於該等估計。

估計及相關假設會持續進行檢討。倘會計估計修訂僅影響修訂估計的期間，則會計估計修訂於該期間確認，或若同時影響當前及未來期間，則於修訂期間及未來期間確認。

2.3 重要會計政策概述

收入及其他收入

本集團將來自銷售貨品或提供服務的收入分類為收入。

當產品或服務的控制權按本集團預期有權獲得的承諾代價金額(不包括代第三方收取的金額)轉移至客戶時確認收入。收入不包括增值稅或其他銷售稅，並已扣除任何貿易折扣。

本集團的收入及其他收入的確認政策進一步詳情如下：

(i) 銷售貨品及提供服務

(a) 銷售芯片產品

當本集團將芯片產品的控制權轉移至客戶(即客戶接收貨品)或履行合約中的履約義務時，確認收入。

(b) 提供服務

管理服務之收入於合約期間內隨時間推移確認，自服務可供客戶使用之日起開始計算。其他服務之收入則於客戶通過驗收且開發結果提交時確認。

(ii) 股息

股息收入於本集團取得收款權的確切日期在損益中予以確認。

(iii) 利息收入

利息收入採用實際利率法確認。「實際利率」為將金融資產預期年期內的估計未來現金收入準確貼現至金融資產賬面總值的利率。在計算利息收入時，實際利率應用於資產的賬面總值(當資產並無信貸減值時)。然而，對於初步確認後已發生信貸減值的金融資產，透過將實際利率應用於該金融資產的攤銷成本而計算利息收入。倘資產不再出現信貸減值，則利息收入的計算將恢復為總額基準。

(iv) 政府補助

當有合理保證將收到政府補助且本集團將遵守其所附條件時，在財務狀況表初步確認政府補助。

補償本集團所產生開支的補助，在產生開支的同一期間按系統化基準在損益中確認為收入。

與資產相關的補助應於資產負債表確認為遞延收入，並於相關資產的使用年限內以合理且系統的方式列入其他淨收入。與收入相關的政府補助乃用於補償未來支出或損失，應確認為遞延收入並於確認相關支出或損失期間列入其他淨收入；其他政府補助應直接列入其他淨收入。

所得稅

所得稅開支包括即期稅項及遞延稅項。除與業務合併或直接於權益或其他全面收益確認的項目有關外，其於損益中確認。

即期稅項包括本年度應課稅收入或虧損的估計應付或應收稅項及對過往年度應付或應收稅項的任何調整。應付或應收的即期稅項金額為反映與所得稅有關的任何不確定性的預期將支付或收取的稅項金額的最佳估計。其使用於報告日期已頒佈或實質上已頒佈的稅率計量。即期稅項亦包括股息產生的任何稅項。

即期稅項資產及負債僅於符合若干標準時予以抵消。

遞延稅項乃就財務報告用途的資產及負債賬面值與用作稅項用途的金額之間的暫時差額確認。概不會就以下各項確認遞延稅項：

- 並非業務合併且不影響會計或應課稅損益及不會產生相等的應課稅及可扣稅暫時差額的交易中的資產或負債初步確認時產生的暫時差額；
- 有關於附屬公司、聯營公司及合營企業的投資的暫時差額，惟以本集團控制暫時差額的撥回時間及於可見將來應不會撥回為限；
- 初步確認商譽時產生的應課稅暫時差額；
- 與為實施經濟合作與發展組織頒佈的第二支柱示範規則而頒佈或實質頒佈的稅法所產生的所得稅有關的暫時差額。

本集團就租賃負債及使用權資產分別確認遞延稅項資產及遞延稅項負債。

遞延稅項資產乃就未動用稅項虧損、未動用稅項抵免及可扣減暫時差額確認，惟以可能有未來應課稅利潤可用作抵消為限。未來應課稅利潤根據相關應課稅暫時差額的撥回釐定。倘應課稅暫時差額不足以悉數確認遞延稅項資產，則根據本集團個別附屬公司的業務計劃考慮未來應課稅利潤(就現有暫時差額的撥回作出調整)。遞延稅項資產於各報告日期進行檢討，並於相關稅項利益不再可能實現時予以扣減；當未來應課稅利潤的可能性提高時，該等扣減會被撥回。

遞延稅項的計量反映於報告日期按本集團預期方式收回或結算資產及負債賬面值的稅務後果。遞延稅項資產及負債僅於符合若干標準時予以抵消。

存貨及合約成本

存貨是指於日常業務過程中持作銷售、在生產過程中銷售或以材料或供應品形式在生產過程中或提供服務過程中所消耗的資產。

存貨按成本與可變現淨值兩者中的較低者列賬如下：

成本按加權平均成本方式計算，其中包括所有採購成本及使存貨運至現時所在地及使其達至現時狀況所產生的其他成本。

可變現淨值為日常業務過程中的估計售價減估計完成成本及進行銷售所需的估計成本。

存貨出售時，存貨的賬面值在相關收入獲確認的期間內確認為開支。

存貨撇減至可變現淨值的金額及存貨的所有虧損，均在撇減或虧損產生期間內確認為開支。存貨撇減的任何撥回金額在撥回期間確認為已確認為開支的存貨金額的扣減。

合約成本

合約成本指未資本化為存貨、物業、廠房及設備或無形資產的從客戶取得合約的增量成本或完成與客戶訂立的合約的成本。

倘若取得合約的增量成本(如銷售佣金)與將於未來報告期間確認的收入有關，且預期可收回該成本，則將該成本資本化。獲取合約的其他成本於發生時支銷。

倘成本直接與現有合約或可特別認定的預計合約相關；產生或強化日後將用於提供貨品或服務的資源；及預期將被收回，則完成合約的成本會予以資本化。否則，完成合約的成本(未資本化為存貨、物業、廠房及設備或無形資產)於產生時支銷。

已資本化合約成本按成本減累計攤銷及減值虧損列賬。當合約成本資產的賬面值超過(i)本集團預期因交換資產相關貨品或服務而將收取的代價餘額減(ii)尚未確認為開支的直接與提供該等貨品或服務相關的任何成本的淨額時，則確認減值虧損。

貿易及其他應收款項

應收款項於本集團有無條件權利收取代價且代價僅隨時間推移即會成為到期應付時予以確認。

不包含重大融資部分的貿易應收款項初步按其交易價格計量。

計息借款

計息借款初步按公允價值減交易成本計量。其後，該等借款採用實際利率法按攤銷成本列賬。

貿易及其他應付款項

貿易及其他應付款項初步按公允價值確認。於初步確認後，貿易及其他應付款項按攤銷成本列賬，除非貼現的影響並不重大，在此情況下，其按發票金額列賬。

2.4 重要會計判斷及估計

存貨的可變現淨值

存貨的可變現淨值為日常業務過程中的估計售價減完成的估計成本及進行銷售所需的估計成本。本集團會特別考慮估計技術上過時及/或滯銷存貨項目的售價。

管理層於報告期末重新評估該等估計，以確保存貨按成本及可變現淨值兩者中的較低者列示。

商譽減值

本集團至少每年釐定商譽是否減值。這需要估計獲分配商譽的現金產生單位的使用價值。估計使用價值時，本集團須估計現金產生單位的預期未來現金流量，亦須選擇合適的貼現率，以計算該等現金流量的現值。

遞延稅項資產

倘應課稅利潤可供扣減虧損，則會就未動用稅項虧損確認遞延稅項資產。釐定可予以確認的遞延稅項資產金額時，管理層須根據未來應課稅利潤可能出現的時間及水平連同未來稅務規劃策略作出重大判斷。

3. 分部信息

公司是一家專注於模擬芯片方向的集成電路設計企業，聚焦於信號鏈產品、電源管理產品、傳感器產品三大產品方向。公司將此業務視作為一個整體實施管理、評估經營成果。因此，本公司無需披露分部信息。

4. 收入

按主要產品或服務劃分的客戶合約收入拆分如下：

	2025年 人民幣千元	2024年 人民幣千元
國際財務報告準則第15號範圍內的客戶合約收入		
按主要產品或服務線拆分		
- 傳感器產品	891,977	273,981
- 信號鏈芯片	1,287,693	963,251
- 電源管理芯片	1,173,695	703,171
- 其他	14,458	19,871
	<u>3,367,823</u>	<u>1,960,274</u>

按收入確認時間劃分的客戶合約收入明細如下：

	2025年 人民幣千元	2024年 人民幣千元
按收入確認時間分類		
時間點	3,361,855	1,951,780
隨時間	<u>5,968</u>	<u>8,494</u>
	<u>3,367,823</u>	<u>1,960,274</u>

5. 按性質分類的費用

	2025年 人民幣千元	2024年 人民幣千元
財務成本		
以下項目的利息		
– 貸款	21,968	15,588
– 租賃負債	<u>703</u>	<u>847</u>
	<u>22,671</u>	<u>16,435</u>

	2025年 人民幣千元	2024年 人民幣千元
員工成本		
薪金、工資及其他福利	916,897	641,240
界定供款退休計劃的供款	60,643	45,388
以權益結算以股份為基礎的交易	<u>86,972</u>	<u>70,895</u>
	<u>1,064,512</u>	<u>757,523</u>

	2025年 人民幣千元	2024年 人民幣千元
其他項目		
折舊費用		
– 自有物業、廠房及設備	176,842	116,636
– 使用權資產	<u>10,000</u>	<u>16,377</u>
	<u>186,842</u>	<u>133,013</u>
無形資產攤銷成本	<u>58,532</u>	<u>24,512</u>
研發開支	<u>794,603</u>	<u>539,992</u>
存貨成本	<u>2,289,590</u>	<u>1,410,928</u>

6. 所得稅開支

綜合損益及其他全面收益表中的稅項指：

	2025年 人民幣千元	2024年 人民幣千元
即期稅項		
年內撥備	<u>3,027</u>	<u>4,124</u>
遞延稅項		
暫時差額的產生及撥回	<u>(15,348)</u>	<u>(5,401)</u>
	<u>(12,321)</u>	<u>(1,277)</u>

7. 每股虧損

(a) 每股基本虧損

每股基本虧損乃根據本公司普通股股東應佔虧損人民幣228,874,000元(2024年：人民幣402,878,000元)及年內已發行普通股加權平均數143,205,000股(2024年：141,187,000股)計算。

資本儲備按每10股增發4股新股份的基準轉換為股本。因此，普通股加權平均數已追溯調整。

普通股加權平均數

	2025年 千股	2024年 千股
於1月1日已發行普通股	142,529	142,529
已發行普通股的影響	1,254	-
持有庫存股的影響	(578)	(1,342)
	<u>143,205</u>	<u>141,187</u>
於12月31日普通股的加權平均數	<u>143,205</u>	<u>141,187</u>

(b) 每股攤薄虧損

截至2025年及2024年12月31日止年度，限制性股份不計入每股攤薄虧損的計算，因為將會產生反攤薄影響。因此，兩個年度內每股攤薄虧損的金額與每股基本虧損的金額相同。

8. 存貨

	2025年 人民幣千元	2024年 人民幣千元
存貨		
芯片產品		
- 原材料	364,662	202,684
- 在製品	553,605	296,680
- 製成品	515,879	313,571
- 在途物資	14,695	4,314
- 交付予客戶的貨物	9,632	5,601
	<u>1,458,473</u>	<u>822,850</u>
合約成本	<u>17,467</u>	<u>9,706</u>
	<u>1,475,940</u>	<u>832,556</u>

9. 貿易及其他應收款項

	2025年 人民幣千元	2024年 人民幣千元
貿易應收款項	636,738	392,573
應收票據	15,765	30,094
	<u>652,503</u>	<u>422,667</u>
以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的 應收票據	<u>31,991</u>	<u>22,727</u>
其他應收款項	30,694	24,168
產能保證金	110,750	76,138
可收回增值稅	40,583	22,606
預付款項	92,960	51,855
其他	36,426	26,820
	<u>995,907</u>	<u>646,981</u>

截至報告期末，貿易應收款項及應收票據按到期日及扣除虧損撥備後的賬齡分析如下：

	2025年 人民幣千元	2024年 人民幣千元
1年內	652,492	420,527
超過1年但少於2年	3	2,120
超過2年但少於3年	8	20
	<u>652,503</u>	<u>422,667</u>

10. 貿易及其他應付款項

	2025年 人民幣千元	2024年 人民幣千元
貿易應付款項	461,838	271,997
應付票據	5,000	0
應計工資	317,039	191,372
其他應付稅項及附加費	15,174	32,971
其他應付款項	3,817	25,562
收購附屬公司的應付款項	37,548	105,976
	<u>840,416</u>	<u>627,878</u>

截至報告期末，貿易應付款項的賬齡分析如下：

	2025年 人民幣千元	2024年 人民幣千元
1年內	448,086	268,297
超過1年但少於2年	12,329	2,797
超過2年但少於3年	520	655
超過3年	903	248
	<u>461,838</u>	<u>271,997</u>

11. 計息借款

計息借款的賬面值分析如下：

	2025年 人民幣千元	2024年 人民幣千元
銀行貸款		
- 有抵押(i)	330,765	353,172
- 已質押(ii)	486,909	472,346
- 無抵押	141,369	-
- 有擔保	8,006	-
	<u>967,049</u>	<u>825,518</u>
其他借款	-	28,285
	<u>967,049</u>	<u>853,803</u>
減：計入「流動負債」的金額	(115,537)	(62,382)
	<u>851,512</u>	<u>791,421</u>

- (i) 截至2025年12月31日，本集團賬面總值為人民幣526,979,000元(2024年：人民幣545,121,000元)的物業、廠房及設備，已作為本集團獲授銀行貸款的抵押。
- (ii) 截至2025年12月31日，本集團已將於麥歌恩集團的股權作為抵押品，提供予信託融資公司。

計息借款的還款時間表分析如下：

	2025年 人民幣千元	2024年 人民幣千元
1年內或按要求	115,537	62,382
1年後但2年內	128,148	101,181
2年後但5年內	615,785	487,830
5年後	107,579	202,410
	<u>851,512</u>	<u>791,421</u>
	<u>967,049</u>	<u>853,803</u>

12. 股息

董事會不建議就截至2025年12月31日止年度派付任何末期股息。2025年度，本公司概無派付或擬派股息(2024年：無)。

董事長致辭

各位股東、投資者及關注本公司發展的朋友們：

2025年是納芯微深耕模擬及混合信號芯片領域、實現跨越式發展的關鍵一年。在全球半導體產業格局調整、國內模擬芯片國產替代推進的行業背景下，公司穩步推進各項經營工作，2025年度實現營業收入人民幣3,367.8百萬元，同比增長71.8%，在產品創新、市場拓展、資本運作等方面完成階段性目標，實現了發展進程中的重要跨越。

產品創新方面，公司持續投入研發資源，推進產品矩陣完善與性能升級。2025年，公司多款核心產品取得階段性成果：車載視頻SerDes接口芯片完成頭部客戶DV驗證；4通道75W ClassD音頻放大器規模化量產，150W款完成設計驗證；功能安全隔離柵極驅動芯片批量出貨，多種磁傳感、汽車專用MCU系列產品有序推進研發及量產導入等，進一步夯實了公司在傳感器、信號鏈、電源管理領域的產品基礎。

市場拓展方面，公司聚焦汽車電子、泛能源、消費電子三大領域，深化核心客戶合作。汽車電子領域，鞏固新能源汽車三電系統業務，同步拓展車身照明、熱管理、智能座艙、底盤安全、智能駕駛等領域，全年汽車電子領域芯片出貨量突破7.50億顆，累計出貨量超過14.18億顆；泛能源領域，受益於製造業復甦、AI服務器需求增長及光伏儲能產業回暖，隔離芯片、驅動芯片、傳感器等產品出貨量提升，市場覆蓋範圍擴大；消費電子領域，推出多款適配新場景的傳感器產品，完成新興應用領域客戶導入。海外市場方面，依託日本、韓國、德國等海外銷售中心逐步拓展本地化服務，向全球領先的制動與底盤控制系統、熱管理領域的多家頭部客戶進行量產供貨，實現海外業務階段性突破。

資本運作方面，2025年12月8日，公司完成H股上市，在香港聯交所主板掛牌交易(股份代號：2676.HK)，正式構建「A+H」雙資本平台。公司將香港定位為海外業務與資本運作重要平台，依託其連接中國與全球資本和人才的樞紐優勢，持續完善海外供應鏈體系與運營中心的建設，全面加速海外佈局與技術創新。

2026年，全球半導體產業格局持續重構，國內模擬芯片國產替代向縱深推進。公司將依託「A+H」雙資本平台，聚焦模擬芯片與傳感器主業，重點開展五項工作：一是持續推進技術創新與成本優化，升級核心技術平台，完善研發體系建設；二是聚焦產品研發與市場深耕，完善全場景產品矩陣，拓展高價值賽道與新興領域；三是深化核心客戶協同合作，完善市場與服務體系建設，加快全球化市場佈局；四是全面強化供應鏈管理與資源統籌，提升供應鏈韌性、自主可控水平與運營效率；五是持續優化組織機制與業務流程，強化人才激勵與領導力建設，提升運營效能。

未來，納芯微將堅守經營初心，以客戶為中心、以技術創新為驅動，嚴格落實經營計劃，穩步推進業務發展，努力實現經營業績持續增長，為股東創造長期價值，為全球模擬芯片產業發展貢獻力量！

蘇州納芯微電子股份有限公司
董事長
王升楊

財務回顧

收入

下表載列本公司2025年度及2024年度按業務劃分的收入的絕對金額和佔收入的百分比：

	截至12月31日止年度				變動
	2025年度		2024年度		
	人民幣千元	佔收入比重	人民幣千元	佔收入比重	
傳感器產品	891,977	26.5%	273,981	14.0%	225.6%
信號鏈芯片	1,287,693	38.2%	963,251	49.1%	33.7%
電源管理芯片	1,173,695	34.9%	703,171	35.9%	66.9%
其他 ⁽¹⁾	14,458	0.4%	19,871	1.0%	-27.2%
總計	3,367,823	100.0%	1,960,274	100.0%	71.8%

附註：

(1) 我們的定製服務及配套組件銷售收入。

2025年度本公司實現收入人民幣33.7億元，同比增長71.8%，其中傳感器產品實現收入人民幣8.92億元，同比增長225.6%；信號鏈芯片實現收入人民幣12.9億元，同比增長33.7%；電源管理芯片實現收入人民幣11.7億元，同比增長66.9%；其他業務實現收入人民幣0.1億元，同比下降27.2%。

分業務來看，傳感器產品實現收入人民幣8.92億元，同比增長225.6%，主要由於麥歌恩併表豐富了公司產品矩陣，對磁傳感器產品營收增長形成積極影響；信號鏈芯片實現收入人民幣12.9億元，同比增長33.7%，主要由於下游汽車電子和泛能源領域需求的增長；電源管理芯片實現收入人民幣11.7億元，同比增長66.9%，主要由於公司電源管理產品實現多品類規模化量產與市場拓展，銷售額同比有較大的提升。

毛利及毛利率

下表載列本公司2025年度及2024年度按業務劃分的毛利絕對金額和毛利率：

	截至12月31日止年度		變動	
	2025年度 人民幣千元	2024年度 人民幣千元		
存貨減值虧損前金額				
傳感器產品	411,101	119,994	242.6%	
信號鏈芯片	457,269	362,126	26.3%	
電源管理芯片	300,478	157,636	90.6%	
其他 ⁽¹⁾	8,346	1,226	580.8%	
小計	<u>1,177,193</u>	<u>640,982</u>	<u>83.7%</u>	
存貨減值虧損	(98,961)	(91,636)		
毛利及毛利率	<u>1,078,233</u>	<u>549,346</u>	<u>28.0%</u>	<u>96.3%</u>

附註：

(1) 主要包括我們的定製服務及配套組件銷售收入。

2025年度本公司毛利率32.0%，同比提升4.0個百分點，主要由於本年度產品矩陣更加豐富，加強高毛利產品組合的銷售，產品結構得到進一步優化；同時深化供應鏈整合以及運營管理效率，不斷加強成本優勢。

銷售及營銷開支

下表載列本公司2025年度及2024年度銷售及營銷開支的金額及佔收入的比重：

	截至12月31日止年度				
	2025年度		2024年度		變動
	人民幣千元	佔收入比重	人民幣千元	佔收入比重	
銷售及營銷開支	<u>260,896</u>	<u>7.7%</u>	<u>188,942</u>	<u>9.6%</u>	<u>38.1%</u>

2025年度本公司銷售及營銷開支人民幣260.9百萬元，同比增長38.1%，銷售及營銷開支費用率7.7%，同比下降1.9個百分點，主要由於公司在市場開拓、人才建設等多方面資源投入的積累使得本期銷售費用中的職工薪酬較上年同期增加，整體銷售費用有所增長，但增長比例小於營收增長比例。

管理費用

下表載列本公司2025年度及2024年度的管理費用的金額及佔收入的比重：

	截至12月31日止年度				
	2025年度		2024年度		變動
	人民幣千元	佔收入比重	人民幣千元	佔收入比重	
管理費用	<u>305,712</u>	<u>9.1%</u>	<u>286,872</u>	<u>14.6%</u>	<u>6.6%</u>

2025年度本公司管理費用人民幣305.7百萬元，同比增長6.6%，管理費用率9.1%，同比下降5.5個百分點，管理費用金額本期變化不大，主要由於公司規模擴張，在不斷加強管理隊伍建設的同時管理人員人數增多，因此人員薪酬總數增加，但增長比例少於營收增長比例。

研發開支

下表載列本公司2025年度及2024年度研發開支的金額及佔收入的比重：

	截至12月31日止年度				變動
	2025年度		2024年度		
	人民幣千元	佔收入比重	人民幣千元	佔收入比重	
研發開支	<u>794,603</u>	<u>23.6%</u>	<u>539,992</u>	<u>27.5%</u>	<u>47.2%</u>

2025年度本公司研發開支人民幣794.6百萬元，同比增長47.2%，研發開支費用率23.6%，同比下降3.9個百分點，主要系公司注重產品矩陣拓展與核心技術深耕，為了把握長期發展的窗口機會、吸引和保留核心人才、持續完善產品矩陣，為後續業務營業收入的增長夯實基礎，公司在研發投入、人才建設等多方面持續投入資源，研發開支總額增加。

其他淨收入

本公司其他收入由2024年度的人民幣98.5百萬元降至2025年度的人民幣77.1百萬元，主要由於2025年度人民幣不斷升值，美元匯率下降，本期匯兌損失較上期大幅增長所致。

財務成本

本公司財務成本由2024年度的人民幣16.4百萬元增加至2025年度的人民幣22.7百萬元，其中(1)貸款費用由2024年度的人民幣15.6百萬元增加至2025年的人民幣22.0百萬元，主要由於公司業務規模不斷擴大，營運資金需求更高所致。(2)租賃負債利息由2024年度的人民幣0.8百萬元減少至2025年度的人民幣0.7百萬元，主要由於公司2025年度整體支付的租金有所減少所致。

年度虧損

本公司年度虧損由2024年度的人民幣402.9百萬元減少至2025年的人民幣228.9百萬元，同比下降43.2%，隨著下游汽車電子領域需求穩健增長，公司汽車電子領域相關產品持續放量；泛能源領域整體呈復甦態勢，其中光伏和儲能、工業自動化領域大部分客戶恢復正常需求，服務器電源客戶需求在AI驅動下增長迅速；麥歌恩併表豐富了公司產品矩陣，其業務貢獻對本期營收增長形成積極影響，因此2025年度虧損金額大幅下降。

綜合財務狀況表

下表載列本公司2025年及2024年12月31日綜合財務狀況表的絕對金額：

	2025年	2024年
	12月31日	12月31日
	人民幣千元	人民幣千元
非流動資產總額	3,503,922	2,985,423
流動資產總額	6,177,578	4,688,153
總資產	9,681,500	7,673,576
非流動負債總額	1,014,811	969,400
流動負債總額	1,051,926	757,062
總負債	2,066,737	1,726,462
流動資產淨值	5,125,652	3,931,091
資產淨值	7,614,763	5,947,114

	2025年 12月31日 人民幣千元	2024年 12月31日 人民幣千元
股本	161,597	142,529
庫存股份	(127,664)	(14,907)
儲備	<u>7,563,249</u>	<u>5,814,722</u>
本公司權益股東應佔權益總額	7,597,182	5,942,344
非控股權益	<u>17,581</u>	<u>4,770</u>
權益總額	<u>7,614,763</u>	<u>5,947,114</u>

本公司非流動資產總額由2024年12月31日的人民幣2,985.4百萬元增至2025年12月31日的人民幣3,503.9百萬元，主要由於物業、廠房及設備增加及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的增加所致。

本公司流動資產總額由2024年12月31日的人民幣4,688.2百萬元增至2025年12月31日的人民幣6,177.6百萬元，主要由於現金及現金等價物和存貨增加所致。

本公司非流動負債總額由2024年12月31日的人民幣969.4百萬元增至2025年12月31日的人民幣1,014.8百萬元，主要由於計息借款增加所致。

本公司流動負債總額由2024年12月31日的人民幣757.1百萬元增至2025年12月31日的人民幣1,051.9百萬元，主要由於貿易及其他應付款項增加所致。

本公司資產淨值由2024年12月31日的人民幣5,947.1百萬元增至2025年12月31日的人民幣7,614.8百萬元，主要由於全球發售所致。

綜合現金流量表

下表載列本公司2025年度及2024年度的現金流量表選定資料：

	2025年度 人民幣千元	2024年度 人民幣千元
經營活動(所用)／所得現金淨額	(626,627)	95,054
投資活動所得／(所用)現金淨額	229,019	(1,099,795)
融資活動所得現金淨額	<u>1,864,105</u>	<u>266,812</u>
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	1,466,497	(737,929)
年初現金及現金等價物	1,012,215	1,751,191
匯率變動影響	<u>(14,385)</u>	<u>(1,047)</u>
年末現金及現金等價物	<u>2,464,327</u>	<u>1,012,215</u>

2025年度本公司經營活動所用的現金淨額為人民幣626.6百萬元，經營活動所用的現金淨額與除所得稅前虧損人民幣241.2百萬元之間的差額主要由於(1)人民幣245.4百萬元的折舊及攤銷；(2)營運資金變動，主要包括存貨及合同成本增加人民幣657.8百萬元，貿易及其他應收款項增加人民幣440.2百萬元，貿易及其他應付款項增加人民幣224.0百萬元。

2025年度本公司投資活動所得的現金淨額為人民幣229.0百萬元，主要包括購買、處置金融資產收到現金淨額人民幣849.9百萬元；一部分被購買物業、廠房及設備以及無形資產支付人民幣402.4百萬元以及支付收購附屬公司人民幣153.9百萬元所抵消。

2025年度本公司融資活動產生的現金淨額為人民幣1,864.1百萬元，主要包括全球發售所得款項人民幣1,915.0百萬元以及支付回購股份款項人民幣112.8百萬元(包括交易佣金及其他費用)。

流動資金及財務資源

本公司保持充足的現金及現金等價物來維持資金的靈活性，公司的現金及現金等價物主要包括銀行及手頭現金、存放於銀行的活期存款及其他流動性高的短期投資，下表載列本公司2025年及2024年12月31日現金及現金等價物的絕對金額：

	2025年 12月31日 人民幣千元	2024年 12月31日 人民幣千元
銀行及手頭現金	2,378,379	1,013,077
其他存放金融機構的存款	87,248	2
總計	<u>2,465,627</u>	<u>1,013,079</u>

本公司現金及現金等價物由2024年12月31日的人民幣1,013.1百萬元增至2025年12月31日的人民幣2,465.6百萬元，主要由於全球發售所得款項所致。

	2025年 12月31日 人民幣千元	2024年 12月31日 人民幣千元
銀行貸款	967,049	825,518
其他借款	—	28,285
減：「計入流動負債」項下的金額	<u>115,537</u>	<u>62,382</u>
總計	<u>851,512</u>	<u>791,421</u>

本公司的流動借款由2024年12月31日的人民幣62.4百萬元增至2025年12月31日的人民幣115.5百萬元，主要由於公司業務發展，營運資金及物業、廠房及設備投入需求增加，增加銀行貸款所致。

本公司非流動借款由2024年12月31日的人民幣791.4百萬元增至2025年12月31日的人民幣851.5百萬元，主要由於公司業務發展，營運資金需求增加，增加銀行貸款所致。

本公司預計未來為公司運營提供資金可獲的融資不會發生重大變動。

本公司保持穩健的資本比率以支持業務，通過資產負債比率管理資產結構，下表載列本公司2025年12月31日及2024年12月31日資產／負債總額的絕對金額及資產負債率：

	2025年 12月31日	2024年 12月31日
資產總額(人民幣千元)	9,681,500	7,673,576
負債總額(人民幣千元)	<u>2,066,737</u>	<u>1,726,462</u>
資產負債率	<u>21.3%</u>	<u>22.5%</u>

本公司資產負債率(定義為負債總額佔資產總額的比例)由2024年12月31日的22.5%減至2025年12月31日的21.3%，主要由於公司在報告期內全球發售帶來的貨幣性資產增加所致。

截至2025年12月31日，本公司流動總額中貨幣性資產佔比約40%，考慮到本公司可動用的財務資源，包括現金及現金等價物、可動用的銀行融資、經營活動產生的現金流量及全球發售的所得款項淨額，本公司擁有至少12個月的充足運營資金。

資本承諾

下表載列本公司2025年及2024年12月31日資本承諾的絕對金額：

	2025年 12月31日 人民幣千元	2024年 12月31日 人民幣千元
已訂約購買物業、廠房及設備	<u>201,878</u>	<u>38,913</u>

本公司2025年12月31日的資本承諾金額為人民幣201.9百萬元，主要係公司為滿足經管規模的快速增長，為保證產能而簽訂的長期資產採購協議。

資本開支

下表載列本公司2025年度及2024年度資本開支的絕對金額：

	2025年度 人民幣千元	2024年度 人民幣千元
支付購買物業、廠房及設備以及無形資產的款項	402,390	397,026
收購子公司支付的現金淨額	153,945	740,432
購買聯營公司支付的款項	<u>20,000</u>	<u>28,000</u>
總計	<u>576,335</u>	<u>1,165,458</u>

本公司的資本開支包括支付購買物業、廠房及設備以及無形資產的款項、收購子公司支付的現金淨額及購買聯營公司支付的款項。本公司資本開支由2024年度的人民幣1,165.5百萬元減少至2025年度的人民幣576.3百萬元，主要由於2024年10月收購麥歌恩的資本支出人民幣740.4百萬元，剔除購買子公司及聯營公司股權影響，本公司資本開支同比變化較小，主要由於本年度模擬芯片和傳感器需求增長，相關產業迎來發展新機遇，公司保持資本投入以滿足產量需求所致；另外，公司始終堅持技術創新與研發投入，因此對研發項目保持持續性投入。

本公司預期以我們的經營現金流量，以及自有或自籌資金為我們的未來資本開支提供資金。

或有負債

截至2025年12月31日，本公司不存在需要披露的重要或有負債。

外匯風險

於2025年12月31日，本集團按浮動利率計息的金融工具為銀行現金(固定存款除外)。由於該等結餘的到期日相對較短，市場利率變動所產生的現金流利率風險被認為並不重大。於2025年及2024年12月31日，本集團按固定利率計息的金融工具包括固定存款、銀行貸款及其他借款，以及按攤銷成本計量的租賃負債；市場利率的變動不會使本集團面臨公允價值利率風險。整體而言，本集團承受的利率風險並不重大。

資產押記

截至2025年12月31日，本公司用於質押或抵押取得銀行借款的抵押物賬面淨值為人民幣1,222.7百萬元，主要為房屋建築物以及股權。

除以上述披露者外，本集團於2025年12月31日並無其他重大資產抵押。

資產負債表外安排

截至2025年12月31日，本公司並無訂立且預期不會訂立任何資產負債表外安排。

管理層討論與分析

一、報告期內公司所處行業情況

(一) 模擬芯片市場概況

1、全球市場概況

2025年，全球半導體市場延續2024年的復甦態勢，實現高速增長，逐步進入週期向上通道。根據世界半導體貿易統計協會(以下簡稱「WSTS」)2026年3月發佈的統計數據，2025年全球半導體營收同比增長26.2%，達到7,956億美元，其中全球模擬芯片市場在2022年達到近年高點後，2023-2024年呈現下滑態勢但2024年降幅收窄，2025年逐步走出庫存調整週期，實現溫和復甦，全年營收同比增長8.7%，市場規模達到865億美元，增長動力主要依託汽車電子、工業自動化及AI數據中心等下游領域的需求釋放，其中AI服務器的高算力密度需求，顯著提升了對電源管理、信號鏈等模擬芯片的用量和性能要求。

WSTS在其2026年3月的統計數據中預計，2026年全球半導體市場將持續高速增長，市場規模將接近萬億美元。根據WSTS 2025年的秋季預測，模擬芯片市場2026年將延續穩健增長態勢，增幅穩定在7.5%，市場規模預計達到919.88億美元。增長動力方面，除工業控制等傳統領域的穩定需求外，AI技術的持續迭代、自動駕駛和機器人的快速發展，將進一步拉動模擬芯片需求，尤其是AI服務器、汽車電子等場景對高性能模擬芯片的需求持續釋放，同時行業庫存已降至健康水平，有望推動模擬芯片市場實現量價穩步提升。

2、國內市場概況

2025年，中國半導體市場保持穩健增長，根據艾媒諮詢的統計數據，2025年中國集成電路市場規模達人民幣1.69萬億元，同比增長16.6%。海關總署統計數據顯示，2025年中國集成電路出口達2,019億美元，同比增長26.8%，首次突破2,000億美元大關並創下歷史新高。

隨著新能源汽車智能化程度的提升、光伏儲能等新能源基礎設施大規模建設以及工業自動化水平提高，2025年中國模擬芯片市場規模持續擴張。根據中商產業研究院統計數據，2025年中國模擬芯片市場規模將增長至人民幣3,431億元，同比增長約5.57%。

基於國產模擬芯片的性能與可靠性持續提升，國產替代進程已從消費電子快速邁向對可靠性要求更高的工業與汽車級市場。AI基礎設施、新能源汽車、智能終端、5G通信和機器人的快速發展，顯著提升了對電源管理、信號鏈等模擬芯片的需求。特別是AI服務器和新能源汽車等領域的發展，進一步推動了電源管理集成電路等產品的需求增長。

(二) 傳感器市場概況

根據Future Business Insights的統計數據，2025年全球傳感器市場規模為2,410.6億美元，預計將從2026年的2,584.7億美元增長到2034年的5,279.4億美元，預測期內複合年增長率為9.30%。根據中商產業研究院統計數據，2024年中國傳感器市場規模為人民幣4,061.2億元，較上年增長11.43%，2025年中國傳感器市場規模將達到人民幣4,525.3億元，2026年市場規模將達到人民幣5,042.4億元。

新能源汽車、工業自動化、智能家居、低空經濟、健康監測、人形機器人等下游領域持續擴容，帶動傳感器需求釋放。汽車智能化領域，隨著L2級輔助駕駛滲透率提升及L3級自動駕駛政策試點推進，磁傳感器、壓力傳感器、激光雷達等需求快速增長。

(三) 主要下游市場概況

1、 汽車電子

根據中國汽車工業協會數據，2025年中國汽車產銷分別完成3,453.1萬輛和3,440.0萬輛，同比分別增長10.4%和9.4%，產銷量再創歷史新高，連續17年穩居全球第一。2025年汽車出口達709.8萬輛，同比增長21.1%，連續第二年成為全球最大汽車出口國。2025年新能源汽車產銷分別完成1,662.6萬輛和1,649.0萬輛，同比分別增長29.0%和28.2%，新能源汽車出口261.5萬輛，同比實現翻番。中國汽車產業的龐大規模和持續增長的勢頭，為國內汽車模擬芯片產業的發展奠定了堅實的基礎，也有望使國內的模擬芯片企業更深入地參與國際市場競爭。

隨著國產品牌汽車佔國內汽車銷量比例從2020年的38.4%提升到2025年的69.5%，國產品牌汽車對供應鏈安全的需求日益凸顯。汽車模擬芯片的國內供應對於建立穩定的供應鏈生態系統至關重要。2024年，中國汽車模擬芯片的國產化率仍然很低，僅為5%，與其他主要下游領域相比，中國汽車模擬芯片的國產化率最低。為了擺脫對進口模擬芯片的依賴，國內汽車品牌積極推動模擬芯片的國產化，以確保供應鏈的自主可控，從而有效帶動中國國內模擬芯片市場的發展。國內模擬芯片企業有望迎接新的機遇，市場佔有率將得到進一步提升。

智能化已成為汽車產業核心發展趨勢，政策與技術雙輪驅動加速滲透。在電氣化和智能化的刺激下，汽車對模擬芯片的需求持續增長，涵蓋電源系統、車身域、駕駛智能座艙、自動駕駛、車載娛樂、車身電子、照明等多個領域。根據弗若斯特沙利文統計和預測，2024年智能新能源汽車模擬芯片單車價值已達人民幣1,500–2,800元，預計2029年將提升至人民幣2,200–4,000元。根據中國汽車工業協會數據，2025年前三季度L2級輔助駕駛功能乘用車滲透率達64%，預計2025年底將達66.1%。智能座艙與自動駕駛功能持續迭代，多傳感器融合方案彌補純視覺方案不足，帶動信號鏈與電源管理芯片需求。在智能駕駛領域，模擬芯片承擔雷達／攝像頭信號調理、傳感器融合及高壓系統隔離等關鍵功能，確保多模態數據實時處理。隨著L2級輔助駕駛滲透率提升及L3級自動駕駛政策試點推進，激光雷達、4D成像毫米波雷達等高端傳感器配套芯片需求將持續釋放。

2、 光伏及儲能

2025年，中國光伏產業在能源綠色轉型戰略的強力驅動下，繼續保持快速發展勢頭。根據國家能源局發佈的官方數據，截至2025年底，我國風電光伏累計併網裝機達到18.4億千瓦，歷史性超過火電；其中，全國光伏發電累計裝機容量歷史性突破12億千瓦，同比增長35%，全國光伏新增裝機容量達3.17億千瓦(317GW)，從裝機結構看，集中式光伏新增1.64億千瓦，分佈式光伏新增1.53億千瓦。中長期來看，隨著全球能源轉型進程持續推進，疊加光伏產業降本增效帶來的經濟性提升，光伏儲能產業的需求端增長預計仍將持續，為相關半導體器件帶來長期需求支撐。

模擬芯片在光伏逆變器、儲能變流器等新能源核心設備中扮演關鍵角色，其技術演進與市場需求升級，驅動行業呈現多維度創新趨勢。2025年，隨著光伏逆變器、儲能變流器向高效化、集成化、小型化方向持續升級，模擬芯片的性能要求進一步提升。在集成化設計方面，模擬芯片已從單一功能模塊向多維度異構融合架構深度演進，核心依託系統級封裝(SiP)技術，將驅動電路、採樣調理、數字接口及電源管理單元集成於單芯片，同時整合被動器件，大幅減少外圍器件數量，不僅縮小PCB佔板面積，更能有效屏蔽電磁干擾，提升光伏設備系統可靠性。此外，集成化設計還可融入智能化感知功能，在芯片內部集成過溫、過流、過壓檢測模塊，實現故障實時監測與快速響應，進一步提升光伏能源轉換系統的安全性與穩定性。

2025年，模擬芯片在光伏領域的應用場景持續拓寬，除傳統光伏逆變器、儲能變流器外，在分佈式光伏、光儲一體化項目中的應用持續推進，需求規模穩步增長。隨著全球能源轉型的深入及我國光伏產業的持續發展，模擬芯片作為光伏新能源設備的核心支撐器件，其市場需求有望持續釋放，為國內模擬芯片企業帶來新的發展機遇，推動行業向高端化、精細化方向升級。

3、工業自動化

2025年，中國工業自動化市場在製造業轉型升級的剛性需求與政策持續加碼的雙重作用下，呈現出「弱復甦」中的結構性增長態勢。根據中研普華產業研究院的統計數據，全球工業自動化市場預計將以CAGR約5.5%的速度穩健增長，到2030年市場規模有望突破3,000億美元；中國市場在「十五五」規劃的政策促進下，CAGR預計將接近8%，到2030年成為全球最大的單一市場，規模超千億美元。這一增長的核心驅動力來自技術與產業的兩翼共振：一方面，人工智能與機器人的深度融合成為最大亮點，AI智能體廣泛滲透至質檢、工藝優化等環節，配合協作機器人的規模化普及，顯著提升了產線的柔性與效率，甚至在一些標桿工廠實現了「黑燈生產」；另一方面，國產替代從局部突破走向全面加速，國產品牌在中低壓變頻器、伺服系統等領域持續侵蝕外資份額，並在部分高端裝備中取得突破。與此同時，工業機器人、伺服系統、PLC等核心產品的國產化率持續提升，本土品牌憑借技術迭代與解決方案能力，市場份額進一步擴大。

在政策支持、技術突破與市場需求共振下，中國工業自動化市場有望實現進一步復甦。長期的核心驅動力將圍繞以下結構性機會展開：一是「AI+」相關產業增長將持續拉動半導體、電子製造等高端領域的自動化設備需求；二是固態電池中試線與鋰電擴產將帶來新一輪設備投資週期；三是以低空經濟、具身智能為代表的新質生產力發展，將為行業開闢全新增長空間。此外，工控出海將成為企業重要的長期增長極，國內領先企業正加速全球化佈局以貢獻業績增量。

4、 AI服務器

2025年，AI服務器延續強勢增長態勢，根據Fortune Business Insights數據，2025年全球AI服務器市場規模達1,946.2億美元，預計2026年將增長至2,622.2億美元，2024–2034年複合年增長率34.73%，2034年市場規模達28,473.2億美元，中國在亞太地區佔據主導地位，約佔全球AI服務器市場份額的14%。

隨著AI服務器性能的提升與功能的增加，模擬芯片在AI服務器中的應用將更廣泛、更深入，尤其是在電源管理、信號轉換、通信接口和散熱管理等關鍵環節。在電源管理領域，AI服務器需要高效的電源管理系統，以確保穩定的電力供應與節能，模擬芯片在此發揮關鍵作用。例如，電源轉換器、穩壓器等，能將輸入電壓轉換為服務器內部不同組件所需的電壓。在信號轉換方面，AI服務器中的各類傳感器和接口，需模擬芯片進行信號轉換與處理，像模數轉換器(ADC)和數模轉換器(DAC)，實現模擬信號與數字信號的轉換，完成數據採集與輸出。此外，AI服務器需高速、可靠的通信接口連接不同設備和網絡，模擬芯片在其中負責信號的放大、濾波與傳輸，如以太網物理層芯片、光纖通信模塊等。在散熱管理的相關環節，隨著AI服務器功率密度提升，液冷技術快速普及，溫控傳感器、風扇驅動等模擬芯片需求持續增長。未來，隨著AI技術的持續發展和市場需求的攀升，AI服務器市場將進一步擴大，這也必然對模擬芯片的性能和可靠性提出更高要求。

5、人形機器人

高工機器人產業研究所(GGII)預測2025年全球人形機器人市場銷量有望達到1.24萬台，市場規模為人民幣63.39億元，到2030年銷量將接近34萬台，市場規模將超過人民幣640億元，到2035年銷量將超過500萬台，市場規模將超過人民幣4,000億元。其中，中國市場在2025年的市場銷量將達到7,300台，市場規模有望接近人民幣24億元；到2030年，銷量將達到16.25萬台，市場規模將超過人民幣250億元；預計到2031年，人形機器人進入快速起量期，到2035年銷量有望達到200萬台左右，屆時中國人形機器人市場規模有望接近人民幣1,400億元。

模擬芯片在人形機器人中發揮著關鍵作用，廣泛應用於人形機器人的電源管理、信號轉換和處理、通信接口、傳感器信號處理以及電機驅動和控制等多個核心領域。在傳感器信號處理方面，溫度傳感器、壓力傳感器、慣性測量單元和磁傳感器等設備產生的信號，均需模擬芯片進行處理，從而實現數據的採集與轉換。隨著人工智能、5G通信和物聯網技術的不斷進步，機器人智能化和自動化程度將進一步提高，應用場景也將愈發廣泛。這無疑將推動模擬芯片需求持續增長，特別是在高性能電源管理、高速信號轉換和處理、以及高精度傳感器信號處理等領域。此外，機器人市場的多元化發展趨勢也將為模擬芯片創造更多的應用機會，如醫療、教育、家庭服務等領域的機器人應用場景，均為模擬芯片提供了廣闊的市場空間。

二、報告期內公司從事的主要業務

(一) 主要業務情況

公司是一家高性能高可靠性模擬及混合信號芯片公司。公司以『「感知」「驅動」未來，共建綠色、智能、互聯互通的「芯」世界』為使命，堅持『可靠、可信賴、持續學習、堅持長期價值』企業價值觀，致力於為數字世界和現實世界的連接提供芯片級解決方案。

公司專注於圍繞下游應用場景組織產品開發，聚焦傳感器、信號鏈和電源管理三大產品方向，提供豐富的半導體產品及解決方案，並被廣泛應用於汽車、泛能源及消費電子領域。目前已能提供3,900餘款可供銷售的產品型號。

報告期內，公司主營業務未發生重大變化。

(二) 主要產品和服務情況

公司產品涵蓋傳感器、信號鏈和電源管理三大產品領域，被廣泛應用於汽車、泛能源及消費電子領域，其中泛能源領域主要是指圍繞能源系統的工業類應用，從發電端、到輸電、到配電、再到用電端的各個領域，包括光伏儲能、數字電源、工業控制、智能電網等。公司產品具體情況如下：



(1) 傳感器產品

公司傳感器產品主要包括磁傳感器、壓力傳感器、溫濕度傳感器，具體如下：

產品類型	主要產品	主要特點
磁傳感器	集成式電流傳感器、線性電流傳感器、輪速傳感器、角度傳感器，工業編碼器，開關與鎖存器，線性位置傳感器等	基於霍爾技術、AMR技術、TMR技術、BFC技術、VHS技術提供高精度的電流檢測、角度檢測、位置檢測等全品類的磁傳感器解決方案，可廣泛應用於汽車電子、工業控制、醫療電子、家電、消費等市場。
壓力傳感器	表壓傳感器、絕壓傳感器、差壓傳感器等	主要基於硅的壓阻效應並採用先進的MEMS微加工工藝，能夠實現寬溫度範圍下的微低壓壓力檢測(-100kPa到400kPa)，同時產品出廠的預校準能大幅簡化客戶系統設計，可廣泛應用於汽車電子、工業控制、醫療電子、白色家電等市場。
溫濕度傳感器	模擬輸出溫度傳感器、數字輸出溫度傳感器、溫濕度傳感器等	主要採用晶體管PN結溫度效應並集成高精度信號調理電路。其超高輸出精度和極低的功耗可廣泛應用於工業、醫療、便攜式設備、家用電器、可穿戴設備以及電腦、服務器等市場，同時豐富的封裝形式也可廣泛適用於多種環境與設備。

(2) 信號鏈產品

信號鏈芯片是系統中信號從輸入到輸出的路徑中使用的芯片，包括信號的收集、放大、傳輸和處理的全部過程，主要包括線性產品、隔離產品、轉換器產品、接口產品等。公司信號鏈產品涵蓋了信號鏈細分領域中的信號調理芯片、隔離器、接口、通用信號鏈、MCU等，具體如下：

產品類型	主要產品	主要特點
傳感器信號調理芯片	MEMS麥克風ASIC、熱電堆傳感器ASIC、PIR傳感器ASIC、壓力傳感器ASIC、磁傳感器ASIC等	信號調理芯片將公司自主設計的各個電路模塊集成至一顆芯片中，能夠實現傳感器信號的採樣、放大、模數轉換、傳感器校準、溫度補償及輸出信號調整等多項功能，性能和成本都得到了大幅優化，是傳感器系統的核心部件，被廣泛應用於汽車電子、工業自動化、智能家居、TWS耳機消費電子等場景。
隔離器系列	數字隔離器、隔離接口、隔離電源、隔離採樣等	基於CMOS工藝，通過電容耦合技術利用電容內部的電場變化來實現數字信號的傳輸。另外，公司在標準數字隔離芯片的基礎上，陸續開發出了超寬體隔離器、「隔離+」產品。「隔離+」產品集成了電源、接口等多類型的數字隔離芯片，能夠同時實現電源、接口隔離和信號隔離，具有高集成度、低成本、小型化等優勢，被廣泛應用於汽車電子、泛能源、消費電子等領域。

產品類型	主要產品	主要特點
接口	CAN/LIN接口、I2C接口、Serdes接口等	接口芯片是基於通用和特定協議且具有通信功能的芯片，廣泛應用於電子系統之間的信號傳輸，可提高系統性能和可靠性。
通用信號鏈	電壓基準、放大器、數據轉換器等	以運放(包括通用運放，精密運放，電流放大器等)、通用的電壓基準、通用比較器、通用模擬開關、分立的ADC/DAC等為基礎的標準模擬信號鏈芯片。在工業、汽車等應用場合作為模擬電路的基礎元器件被廣泛使用。
MCU	實時控制MCU/DSP、通用MCU、嵌入式處理器MCU+	實時控制MCU/DSP通過高主頻高算力ARM內核加上自研的數學運算加速核，搭配為實時控制優化的專用外設，可提高系統控制的實時性；MCU+產品則強調模擬外設的高集成度和針對應用優化的專用性，由一個小的MCU內核集成電源、接口、電機驅動的功率和驅動級模擬電路或者傳感器的信號處理模擬前端電路，上述相關產品可應用於光伏儲能、電源模塊、伺服變頻、汽車電子、智能家居等場景。

(3) 電源管理產品

電源管理芯片是在電子設備系統中實現對電能的變換、分配、檢測及其他電能管理職責的芯片，是電子設備中的關鍵器件，電源管理芯片同步於電子產品技術和應用領域升級，產品種類繁多。公司的電源管理產品主要包括柵極驅動、供電電源、LED驅動、電機驅動、音頻功放、功率路徑保護等，具體如下：

產品類型	主要產品	主要特點
柵極驅動	隔離驅動、非隔離驅動等	用來驅動MOSFET、IGBT、SiC、GaN等功率器件的芯片，能夠放大控制芯片(MCU)的邏輯信號，包括放大電壓幅度、增強電流輸出能力，以實現快速開啟和關斷功率器件。被廣泛應用在工業、通信、新能源汽車等不同領域的開關電源和電機控制設計中。
電機驅動	直流有刷電機驅動、繼電器與螺線管驅動、步進電機驅動等	用來驅動BDC、Stepper、Relay、Valve、BLDC等多種電機負載的芯片，能夠在控制芯片(MCU)的邏輯信號輸入下，開通或切換驅動輸出，以實現系統驅動多種電機負載按需求動作。被廣泛應用在工業，汽車等不同領域的電機控制設計中。
音頻功放	音頻功率放大器等	用來放大前級弱信號並驅動揚聲器發出聲音，主要為車規級中大功率D類音頻功放，支持負載短路、開路、過流等各種診斷與保護功能。

產品類型	主要產品	主要特點
功率器件	SiC二極管及MOSFET等	是電子系統中用於控制和轉換電能的核心元件，在中、高功率應用場景中發揮著至關重要的作用。碳化硅(SiC)材料因其固有的寬禁帶特性以及良好的導熱性能，使得基於該材料的功率器件在高效能量轉換、快速開關速度、高耐壓和低導通損耗方面表現出色。廣泛適用於新能源汽車、光伏、儲能系統等領域。
LED驅動	線性LED驅動、開關型LED驅動等	支持完整的診斷保護，並具有恒流精度高和散熱能力強等特點，主要應用於汽車尾燈、前燈、內飾氛圍燈等場景。
供電電源	DC-DC、LDO、電壓監控、SBC、PMIC等	專為汽車電池供電應用場景而設計，為待機系統中的MCU和CAN/LIN收發器供電，可實現降低系統功耗和延長電池壽命的目的
功率路徑保護	高低邊開關、電子保險絲等	適合驅動阻性、容性、感性等多種負載類型，並支持完整的診斷保護功能。主要應用於車身控制器、整車控制器、配電控制器、BMS等場景。

(三) 經營情況討論分析

公司專注主營業務發展，圍繞下游應用場景組織產品開發，聚焦傳感器、信號鏈和電源管理三大產品方向，提供豐富的半導體產品及解決方案，並被廣泛應用於汽車、泛能源及消費電子領域，目前已能提供3,900餘款可供銷售的產品型號。報告期內公司經營情況如下：

1、經營業績情況

2025年，公司實現營業收入人民幣3,367.8百萬元，同比增長71.8%；本期歸屬於上市公司股東的淨虧損為人民幣228.9百萬元，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損為人民幣286.3百萬元。公司從第一季度營收人民幣717.1百萬元到第四季度營收人民幣1,002.3百萬元，累計實現連續十一季度的營收環比增長，整體經營業績處於快速增長態勢。具體情況如下：

報告期內，隨著下游汽車電子領域需求穩健增長，公司在該領域相關產品持續放量；泛能源領域整體呈復甦態勢，其中光伏和儲能、工業自動化領域大部分客戶恢復正常需求，服務器電源客戶需求在AI驅動下增長迅速；麥歌恩併表豐富了公司產品矩陣，其業務貢獻對本期營收增長形成積極影響。

本期歸屬於上市公司股東的淨虧損和歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損改善主要原因是：1)在收入端，下游市場需求回暖，新產品放量和麥歌恩併表，帶動公司出貨量和營收實現大幅增長；2)在費用端，公司持續深化精益管理與組織提效，公司整體費用佔營業收入比例下降，推動了盈利能力的改善。

2、研發情況

公司始終堅持技術創新與研發投入，2025年度研發費用為人民幣794.6百萬元，同比增長47.2%，主要係公司注重人才、技術積累，在研發投入、人才建設等多方面持續的資源投入，公司規模擴張，研發投入總額整體增加，其中主要為研發人員及其平均薪酬的增加所致。截至2025年12月末，公司研發人員人數為655人，同比增長17.0%；2025年公司研發人員平均薪酬為人民幣83.55萬元／人，同比增長23.83%。具體情況如下：

- (1) 傳感器產品。在磁傳感器方向，報告期內，公司磁傳感器產品線多項核心產品研發按計劃順利推進。其中，基於閉環鎖定技術的電流傳感器研發進展順利；超低抖動(jitter)輪速傳感器研發工作順利推進，即將進入量產導入階段；第二代電感接近開關專用芯片項目研發進展順利。此外，公司基於霍爾磁感應、電渦流感應兩種不同技術原理的兩款高精度游標絕對值編碼器芯片研發工作順利推進，該類產品集成了公司多年積累的非線性自校準算法，可大幅優化客戶端安裝適配性與使用體驗，使公司形成了由磁編碼器與電感編碼器並行的技術佈局，可覆蓋從通用控制到高精度運動控制的不同需求，為伺服電機、步進電機及機器人關節等應用場景提供位置反饋方案。支持低功耗模式與喚醒功能的汽車3D角度傳感器研發進展順利；優化了抗外磁場諧波性能與雙路同步性能的新一代差分霍爾汽車級角度傳感器研發工作順利推進，進一步豐富了公司汽車類角度傳感器產品矩陣。

在壓力傳感器方向，耐惡劣介質的絕對壓力傳感器已成功導入量產，可滿足日益嚴苛的環保排放要求。溫濕度傳感器方向，公司推出了集成新一代溫度控溫校準技術的傳感器產品，相關樣品各項性能指標均已滿足設計與應用需求。

- (2) 信號鏈產品。隔離產品方向，報告期內，公司隔離產品線持續迭代升級並推出多款全新產品。其中，新一代數字隔離器在實現成本顯著優化的同時，EMI性能達到汽車級最高EMC等級，已實現新能源汽車領域的規模化應用；公司同步推出「小型化+密腳寬體」三通道數字隔離器、新一代隔離CAN芯片及寬壓隔離電壓採樣芯片，產品可全面覆蓋從緊湊空間佈局到高壓採樣的全場景應用需求。報告期內，公司接口產品線持續拓展汽車級產品佈局，公司推出了首款Mini SBC、高性能國產化產業鏈的CAN芯片，滿足車廠的應用需求；在高速接口方向，車載視頻SerDes接口芯片在頭部汽車客戶完成DV驗證，該芯片採用全國產化產業鏈，符合國標HSMT協議，可實現互聯互通，傳輸速率高達6.4 Gbps，可廣泛應用於車載ADAS與智能座艙系統。

在通用信號鏈方向，自2024年第三季度起陸續推出通用運算放大器、電流採樣運算放大器兩大品類產品。截至2025年12月31日，公司已實現該品類超20款產品的規模化量產，累計服務客戶超200家。

汽車專用MCU+模擬類產品，公司推出NovoGenius系列，於2025年完成三大汽車智能終端應用節點的產品佈局，具體包括：面向汽車終端節點電機與執行器應用的NSUC16xx系列、面向汽車內飾氛圍燈應用的NSUC15xx系列，以及面向汽車終端智能傳感器(超聲波雷達、陽光雨量傳感器等應用)的NSUC18xx系列。其中，NSUC16xx系列、NSUC15xx系列產品於2025年均已實現規模化量產出貨與整車裝車應用；NSUC18xx系列於2025年第四季度完成客戶端送樣與測試導入工作。預計上述產品系列將在未來數年內逐步成為公司新的業務增長點。

公司MEMS麥克風ASIC產品線業務實現穩步增長，2025年全年產品出貨量超16億顆，公司已在該細分領域逐步成長為行業內重要的市場參與者。後續公司將持續在更高信噪比、更低功耗的硅麥ASIC產品領域加大研發投入，進一步鞏固並提升市場競爭力。

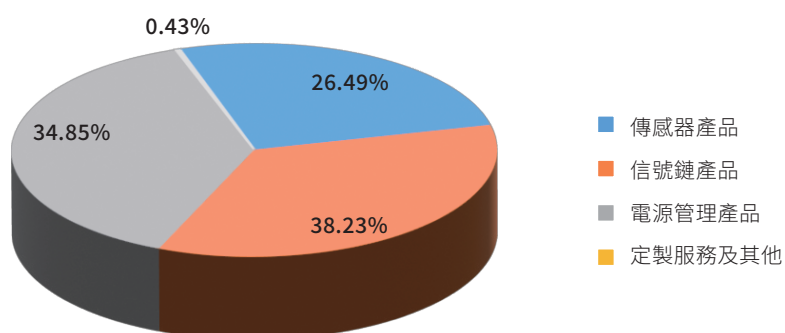
- (3) 電源管理產品。報告期內，公司驅動產品線實現多品類規模化落地與市場拓展。隔離柵極驅動領域，公司第二代智能隔離柵極驅動芯片自2025年第一季度量產以來，出貨量實現持續穩步增長；第一代功能安全隔離柵極驅動芯片持續新增整車廠車型定點項目，累計出貨量達數十萬顆。上述兩大系列產品的規模化量產，進一步提升了公司在汽車主驅領域的市場份額與行業競爭力。非隔離柵極驅動領域，面向汽車激光雷達應用的GaN驅動芯片、面向AI服務器電源應用的高壓GaN驅動芯片均已實現批量發貨；中低壓GaN合封類產品已完成AI電源領域目標客戶的送樣測試工作。

電機驅動產品領域，公司第一代多路集成半橋驅動芯片、多路直流有刷預驅芯片市場份額實現持續提升；低邊驅動芯片、多路可配置高低邊驅動芯片已進入規模化量產階段。音頻功放產品領域，公司實現關鍵技術與產品突破，首款4通道75WClassD音頻放大器已進入規模化量產階段，並完成多家頭部汽車客戶的小批量驗證工作；4通道150WClassD音頻放大器已完成客戶端設計驗證，進入小批量驗證階段。

在LED驅動方向，面向汽車尾燈應用的LED驅動芯片市場份額持續提升；面向汽車前燈照明解決方案的Boost升壓芯片、恒流源降壓芯片及矩陣控制芯片已啟動客戶端送樣。上述全新LED驅動類產品的研發落地，顯著提升了公司在汽車照明領域整體解決方案的覆蓋能力，進一步增強了與下遊客戶的合作粘性。在供電電源方向，公司車規通用電源類40V和6V LDO、40V和6V降壓型DC-DC市場份額持續提升；首款為ECU系統、MCU供電的SBC及首顆專為車載攝像頭設計的PMIC均已啟動送樣，進一步實現了對汽車核心電源節點的產品覆蓋。在功率路徑保護方向，高邊開關係列持續擴品，相關產品已規模量產並導入多家頭部車企供應鏈。

報告期內，公司產品結構營收情況如下：

2025年度產品結構



3、市場應用情況

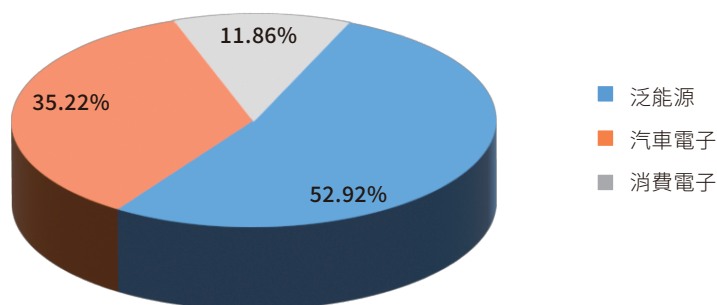
2025年，汽車電子市場延續全年高景氣度，國內新能源汽車行業產銷規模再創新高，行業電動化、智能化趨勢持續深化，L2級輔助駕駛滲透率突破60%，800V高壓平台及1000V架構加速普及，驅動汽車電子領域業務實現高速增長。憑借在汽車領域的深耕細作，公司已實現了全面的汽車芯片產品佈局，可在新能源汽車三電、汽車照明、汽車電控、車身域控、燃油車動力系統、熱管理、智能座艙、底盤安全等中提供涵蓋傳感器、信號鏈、電源管理等完善的芯片產品，包括數字隔離器、隔離驅動、隔離採樣、傳感器、LED驅動、通用接口、功率路徑保護、輪速傳感器、電機驅動、Class D音頻功放、實時控制MCU、車載SoC芯片、SerDes接口等，以一站式解決方案支持客戶的系統創新。報告期內，公司在汽車電子領域出貨量已達7.5億顆，累計出貨量已超過14.18億顆。公司將繼續以技術創新驅動產品迭代，深化與頭部客戶的協同合作，持續提升在汽車電子芯片領域的市場份額與行業影響力。

在泛能源領域中，工控領域伴隨製造業回暖穩健增長，整體呈「低庫存+溫和復甦」，工業自動化設備、電機驅動等需求持續恢復；光伏新能源領域受益於行業政策優化、技術升級及終端需求釋放等多重紅利，全年需求呈現持續復甦態勢，產業鏈發展生態持續優化；電源模塊領域實現顯著增長，核心受益於AI服務器等下游需求的強勁拉動，公司可為服務器電源一二級電源PSU提供驅動、隔離芯片、MCU等產品，目前部分產品已在國內外服務器電源客戶中量產出貨；在人形機器人領域，公司的磁編碼器可在靈巧手中實現精細動作控制，各類傳感器、電源產品、接口等可實現感知與通信功能，動力電池BMS系統亦可使用公司的電源產品、電流傳感器、溫度傳感器等；總體來說，泛能源市場今年整體呈現明顯回暖狀況。

與此同時，消費電子市場持續復甦，其中智能手機、可穿戴設備、智能家居等帶動MEMS傳感器需求，3D打印、無人機和掃地機器人等市場均呈現高景氣度態勢。

從下游應用的收入結構來看，汽車電子領域收入佔比為35.22%，較上年同期佔比36.88%略有下降；泛能源領域收入佔比為52.92%，較上年同期佔比49.49%略有上升；公司在消費電子領域的營收佔比為11.86%，較上年同期佔比13.63%略有下降。

2025年度下游應用領域佔比



4、 內部管理情況

在供應鏈戰略佈局上，公司持續深化雙循環供應鏈佈局和協同機制，推進多元化合作。在晶圓製造端，持續加強工藝能力建設與技術迭代，構築核心技術領域的競爭護城河。在封測領域，通過垂直整合供應鏈資源，強化對封裝、測試環節的協同管理，推動代工成本優化與效率提升；同時，積極拓展國產主材供應商體系，穩步提升關鍵物料國產化比例，增強供應鏈自主可控能力。以戰略前瞻性與運營韌性為核心導向，憑借與核心供應商的緊密協作，通過精細化運營、前置產能規劃及動態庫存策略，有力支撐了業務規模的快速爬升與市場響應速度。

在運營與管理方面，繼續優化矩陣式組織管理模式，強化跨部門協同與資源統籌，通過AI等工具和採購數字化提升管理效率，有效助力採購成本降低與資源優化配置。公司始終聚焦供應鏈的敏捷性、安全性與可持續性，深化與合作夥伴的戰略互信與技術共進，構建更具韌性、更高效協同的全球供應鏈體系，為公司在複雜多變的市場環境中保持競爭優勢夯實基礎。

在體系認證方面，公司IATF16949支持場所認證通過，標誌著公司質量管理與國際一線車規供應鏈標準全面接軌，車規級產品交付能力實現制度化保障。同時，功能安全管理體系通過德國萊茵TUV的嚴格審核，正式獲得ISO 26262 ASIL D「Defined-Practiced」級別認證；部分核心芯片自主可控達C級以上，關鍵環節擺脫外部依賴，核心供應鏈自主權提升，有效應對產業鏈波動風險。

公司憑借在研發管理、質量保障、流程建設方面的體系建設能力提升，為汽車電子等安全關鍵型芯片的全球化交付奠定了堅實基礎。

5、人才建設情況

公司始終將組織人才發展和人才梯隊建設作為可持續發展的核心戰略，致力於構建學習型組織與全球化人才體系，為企業長期發展注入核心動能。

報告期內，公司持續推進各層級人才發展項目，包括應屆生培養項目、高潛業務骨幹發展項目、新晉管理者轉身計劃、管理領導力項目等多個專項，並首次舉辦領導力峰會。此外，公司開展了首屆技術專家提名與認證，並持續深化內部知識分享機制。截至2025年末，內部培訓講師增至200餘人，共計舉辦了238場員工培訓，受訓近7,177人次，實現了100%員工覆蓋。

報告期內，公司順利完成麥歌恩業務及組織人員融合，保證了相關業務運營的平穩銜接與過渡；同時，為了配合海外業務戰略拓展，公司積極構建全球化人才體系，報告期內在日、韓、德等國家開展定向招聘以及海外派遣，引入具備跨文化背景的專業人才。此外，公司已建立較為全面的員工激勵機制，公司持續搭建並優化分層分類激勵機制，通過短中長期激勵的覆蓋和多層次業務領域的差異化激勵，將員工績效薪酬等與公司成長相掛鉤，充分調動員工的工作積極性和創造力。

6、資本運作情況

公司於2025年12月8日在香港聯交所主板掛牌並上市交易，H股股份中文簡稱為「納芯微」，英文簡稱為「NOVOSENSE」，股份代號為「2676」。全球發售H股總數為20,095,000股(2026年1月2日行使超額配售權之後)，發售價為116港元/股。通過本次H股上市，公司引入國家集成電路產業投資基金三期、元禾控股、比亞迪全資附屬公司Golden Link、三花控股全資附屬公司好易得國際、Perseverance Asset Management、3W Fund、小米全資附屬公司Green Better、Dream'ee HK Fund等多家國家級、產業內、財務性的基石投資者，進一步提高了公司綜合競爭力，深入推進公司的國際化戰略，同時更好地利用國際資本市場，豐富多元化融資渠道。

三、核心競爭力分析

1、核心技術及研發優勢

(1) 核心技術儲備豐富

公司作為集成電路設計企業，擁有專業的模擬芯片研發能力，並深度參與後續封裝框架和測試軟件的搭建，建立了從芯片定義到設計及交付的完整管控體系。憑借多年的研發積累，公司以信號鏈技術為基礎，在模擬及混合信號領域開展了自主研發工作，並在傳感器、信號鏈、電源、驅動、第三代功率半導體等五大領域形成了多項核心技術，廣泛應用於各類自研模擬及混合信號芯片產品中，主要產品的核心技術指標達到或優於國際競品水平。

(2) 非標產品設計能力突出

為了滿足下遊客戶的應用需求，公司可根據客戶的參數條件定製開發相應產品，如為客戶開發輪速傳感器、側邊氣囊壓力傳感器等傳感器類產品及低邊驅動等電源管理產品等，滿足下游汽車客戶不同的產品使用需求。此外，公司可應客戶的需求設計芯片、提供定製化封裝和測試方法，並深度參與到客戶的產品驗證、測試等工序的設計和搭建，為客戶提供從芯片設計、產品適配到批量標定校準等多環節服務。憑借自身對行業的理解和技術積累，公司幫助多家下遊客戶成功進入目標汽車廠商的合格供應體系。

2、 質量管控優勢

公司高度重視產品質量的可靠性，始終堅持高標準的質量要求。公司以「可靠可信賴」的質量方針為根本遵循，從產品的研發到生產的過程中，堅持嚴格的質量管控，為客戶提供穩定可靠的產品；以客戶滿意為宗旨，堅守對客戶的承諾，持續不斷的改進產品和服務，成為客戶可信賴的公司。公司秉承著「質量從設計開始並貫穿整個產品生命週期」的質量管理理念，構建了全面質量管理體系，並通過組織能力建設以及流程體系IT化建設確保全面質量管理體系的落實和執行，持續不斷地追求「零缺陷」的質量目標。在車規級產品領域，公司圍繞跨部門協同、車規級質量體系、車規標準下的產品設計開發、生產工藝控制及AEC-Q系列可靠性認證，建立覆蓋全生命週期的車規級質量管理體系，滿足車規級客戶的各項要求。

3、 產品品類優勢

經過多年的持續開發，公司可提供從信號採集到信號處理、傳輸的全鏈路產品，擁有從供電、驅動到功率路徑保護的產品矩陣，並覆蓋磁、壓力、溫濕度等多種傳感器產品，圍繞下游應用場景建立了豐富的產品品類，具有從消費級、工業級到車規級的產品覆蓋能力。公司持續研發，報告期內圍繞三大產品方向研發或推出了多款新品，包括傳感器方向的高精度游標絕對值編碼器芯片(霍爾/電渦流雙技術路徑)、汽車3D角度芯片、超低抖動輪速傳感器、耐惡劣介質絕對壓力傳感器，信號鏈方向的新一代數字隔離器、隔離CAN芯片、車載SerDes接口芯片、汽車專用MCU (NovoGenius系列)及通用信號鏈，電源管理方向的第二代智能隔離柵極驅動芯片、功能安全隔離柵極驅動芯片、GaN驅動芯片(用於激光雷達/AI服務器)、多路集成半橋驅動芯片、ClassD音頻放大器以及車載專用PMIC與SBC等。

4、 客戶資源優勢

憑借過硬的技術研發實力以及優秀的產品口碑，公司取得了眾多行業龍頭標桿客戶的認可。此外，公司擁有豐富的面向汽車前裝市場模擬芯片、傳感器、專用MCU等產品定義、開發和量產經驗。相較其他領域公司來說，汽車客戶的認證週期長且測試嚴格，對產品的技術和質量要求更高，公司車規級芯片已在大量主流整車廠商／汽車一級供應商實現批量裝車。獲得行業標桿客戶的認證也有利於公司在相同領域客戶的商業拓展，進一步擴大領先優勢。

5、 供應鏈優勢

在晶圓製造方面，公司已與主要供應商保持長期、穩定的合作關係。在芯片封裝及測試方面，公司與主要封裝測試供應商深度合作多年，已形成了穩定的封裝測試工藝，併購入了專用測試設備交由部分測試廠商進行芯片測試，綁定了專屬產能。同時，隨著經營規模的快速增長，公司已自建封測工廠，將壓力傳感器及定製化產品自行封測，保證公司產能需求和控制成本，降低了行業產能波動對公司產品產量、供貨週期的影響。

四、 公司未來發展的展望

公司發展戰略

公司專注於模擬及混合信號芯片的技術領域。未來，公司將繼續圍繞傳感器、信號鏈和電源管理三大產品方向，不斷突破產品發展的技術瓶頸，聚焦目標行業和頭部客戶持續應用創新，豐富產品品類，致力於成為泛能源和汽車電子領域佔據領導地位的完整芯片解決方案提供商。

2026年經營重點

2026年，公司將始終堅持長期價值主義經營理念，錨定「泛能源和汽車電子領域佔據領導地位的完整芯片解決方案提供商」的戰略目標，「以客戶為中心、以組織能力為根基」為核心主線，圍繞持續技術創新、深化核心下游領域佈局、深耕主要客戶合作、強化供應鏈管理、組織提效建設五大核心方向，推動產品矩陣從「國產替代」向「業內領先」升級，深化高價值賽道佈局，優化成本與產品結構，努力實現營業收入穩健增長、持續改善盈利能力。具體經營計劃如下：

一、持續技術創新與成本優化

2026年，公司將圍繞技術創新與成本優化兩大方向，系統推進新技術預研及研發體系升級，持續鞏固產品競爭優勢，為產品研發與市場拓展提供堅實支撐。

(一) 技術創新

公司將持續深化「隔離+」、傳感器兩大核心技術平台的創新迭代，並加大技術平台預研投入。推進下一代隔離工藝平台量產，推動霍爾器件迭代拓展及下一代磁傳感器工藝開發，以核心工藝構築產品護城河；在BCD工藝領域，推進第一代車規BCD工藝平台產品導入量產，推動第二代車規BCD工藝平台創新迭代，通過設計與工藝協同優化提升產品競爭力；深化與晶圓廠合作，優化高邊工藝平台，打造高可靠性產品。

圍繞應用創新，公司依託差異化解決方案，針對下遊客戶定製化需求開發專屬產品，持續迭代核心旗艦產品；推進高集成度SoC、車規級芯片平台化開發，聚焦功能安全、高壓隔離、高精度傳感等核心需求，提升產品集成度與可靠性，縮短研發週期、降低研發成本。

(二) 成本優化

公司聚焦成本管控目標，落地多項降本舉措，實現技術成果快速復用，達成成本優化目標。具體包括：通過下一代隔離工藝平台量產降低相關產品成本；落地封裝工藝降本優化及基於隔離工藝的窄切割道技術，提升技術復用率，降低研發與生產成本；在BCD工藝平台迭代中，通過設計-工藝聯合優化，打造兼具性能與成本優勢的工藝平台，進一步優化產品成本結構。

另外，公司將持續推動研發體系升級與能力建設，為產品開發高效執行提供體系保障。構建以電路設計平台、工程平台、系統應用平台為核心的技術管理體系，系統化推進技術能力建設；持續強化功能安全、物理仿真、AI工具應用等關鍵技術能力，夯實技術底座，提升研發效率與產品開發質量。

二、 聚焦產品研發與市場拓展，持續完善業務佈局

2026年，公司將持續集中資源投入新產品研發，並對成熟市場產品持續優化升級。

依託汽車電子、光儲、智能電網等高速增長市場，公司將持續推進產品開發，不斷完善全場景產品矩陣，緊抓模擬芯片國產化率提升機遇，構建梯次遞進的市場與業務組合，為長期可持續發展夯實基礎。在核心產品研發方面，公司將集中資源保障功能安全直流電機驅動、下一代功能安全柵極驅動、實時控制MCU、下一代汽車馬達控制SoC、新一代車規級高邊開關、車載開關電源、AI電源功率級、基於磁技術的位置和角度傳感器、下一代CAN接口及車載SerDes接口等關鍵新產品的研發進度。

公司將持續深耕泛能源與新能源汽車三電核心市場，不斷擴大隔離類、電流傳感器等優勢產品市場份額，完善全場景解決方案能力，全面提升產品競爭力，穩固並擴大核心業務優勢。同時持續攻堅車身照明、熱管理市場，加速客戶導入與量產落地，完善汽車照明全系列芯片、熱管理系統配套芯片產品矩陣，提升市場滲透率與客戶覆蓋度；全力推進智能座艙、ADAS智駕市場拓展，加速車載SerDes接口芯片、座艙域配套芯片、智駕系統傳感器配套芯片等產品的客戶驗證與量產落地。

公司將密切跟蹤行業技術與市場發展趨勢，積極佈局智能終端、AI服務器電源、人形機器人、工業48V系統等新興領域，推進相關專用芯片研發與客戶導入，把握新賽道發展機遇，持續拓寬產品應用邊界。

三、深化客戶協同合作，完善市場體系建設

公司堅持產業聚焦發展戰略，始終以客戶為中心，持續深化與國內外核心客戶的協同合作。不斷優化市場服務體系，大力提升產品在汽車電子、泛能源、消費電子等重點領域的市場滲透與應用推廣。建立健全客戶需求快速響應與問題閉環解決機制，依託聯合創新、定製化開發等模式，精準匹配客戶差異化需求，持續增強客戶信任度與忠誠度。深化與國內頭部整車廠、國際Tier1廠商及工業、新能源領域優質客戶的戰略合作，推動公司由芯片供應商向系統級解決方案服務商轉型升級，穩步提升產品在核心客戶體系中的配套份額與價值貢獻。

持續優化銷售管理體系，提升FAE技術團隊專業能力，強化複雜系統級產品全流程技術支撐，保障新產品快速落地推廣；完善全渠道銷售佈局，實現下游多場景、多層級客戶深度覆蓋。依託A+H雙資本平台，加快全球化市場佈局，健全海外運營與服務體系，積極拓展海外頭部整車廠、工業客戶及國際Tier1廠商合作，推進產品海外認證與量產導入。持續做強日本、韓國、德國等海外據點建設，按需完善區域佈局，構建本地化銷售、技術支持與客戶服務體系，全面提升海外市場響應效率與綜合服務能力。

四、強化供應鏈全流程管理，構建安全韌性的供應保障體系

面對複雜且快速變化的市場環境，公司堅定不移強化供應鏈全面管理能力，憑借與核心供應商的緊密協作，通過精細化運營、前置產能規劃及動態庫存策略，有力支撐業務規模快速提升與市場持續拓展。

在供應鏈戰略佈局方面，公司持續深化與各戰略供應商的全方位合作，通過長期供需聯動、工藝創新共建、專線建設等方式，持續提升供應鏈綜合競爭力。在晶圓製造環節，持續加強工藝能力建設與技術迭代，構築核心技術領域的競爭壁壘；在封測環節，通過垂直整合供應鏈資源，強化封裝、測試環節的協同管理，推動代工成本優化與運營效率提升。同時，公司持續積極拓展國產主材供應商體系，穩步提升關鍵物料國產化比例，增強供應鏈自主可控水平，依託雙循環供應鏈佈局，持續保障供應鏈業務連續性。

在運營管理方面，公司持續優化矩陣式組織管理模式，強化跨部門協同與資源統籌，通過AI智能工具及採購數字化建設提升管理效率，助力採購成本優化與資源高效配置。

公司將始終聚焦供應鏈敏捷性、安全性與可持續性，深化與合作夥伴的戰略互信與技術協同，構建高韌性、高效協同的全球化供應鏈體系。同時不斷強化供應鏈精細化管理，完善庫存管控體系，科學統籌物料規劃與庫存水平，提升運營效率與成本管控能力，為公司業務持續健康發展提供堅實可靠的供應鏈保障。

五、組織機制優化與領導力建設

為促進公司經營的可持續發展，2026年，公司將持續優化團隊結構，提升管理團隊運營效率，全面推進組織能力建設，實現從核心團隊驅動向組織驅動的轉型，以組織能力的持續提升支撐公司長期穩健發展。建立並完善核心管理者制度以及激勵約束管理制度，強化管理團隊的領導力與執行力；優化銷售、研發以及通用項目的激勵機制，充分激發員工的工作積極性與創造力；同時健全中高級管理者長效激勵機制，吸引並留住優秀人才，為公司發展築牢人才根基。

在業務流程優化與組織效能提升方面，公司將持續優化變革常態化運作機制，建立流程度量指標體系，推行分級流程審計機制，通過不斷梳理和優化業務流程，及時發現並化解業務環節中的痛點與難點問題，降低運營成本，提升運營效率。此外，進一步完善各級流程決策組織的運作機制，優化通用項目的運作和管理流程，提升項目管理的規範化水平與執行效率，確保公司各項業務平穩、高效推進。

風險因素

1、業績大幅下滑或虧損的風險

本期歸屬於上市公司股東的淨虧損為人民幣228.9百萬元，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損為人民幣286.3百萬元；本期歸屬於上市公司股東的淨虧損和歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損改善主要原因是：1)在收入端，下游市場需求回暖，新產品放量和麥歌恩併表，帶動公司出貨量和營收實現大幅增長；2)在費用端，公司持續深化精益管理與組織提效，公司整體費用佔營業收入比例下降，推動了盈利能力的改善。

公司主營業務、核心競爭力、主要財務指標未發生重大不利變化，與行業趨勢一致。如果後期下游終端市場需求持續下降、市場競爭加劇、宏觀景氣度下行、國家產業政策變化、公司客戶拓展情況不及預期等情形，公司業績可能存在持續下滑或虧損的風險。

2、核心競爭力風險

(1) 持續技術創新能力不足的風險

公司主要從事模擬芯片的研發、設計與銷售，所屬行業為集成電路設計行業。集成電路設計行業為典型的技術密集型行業，持續技術創新是公司在市場中保持競爭優勢的重要手段。隨著市場競爭的加劇以及終端客戶產品應用場景的不斷豐富，公司需要根據技術發展趨勢和終端客戶需求不斷優化現有產品並研發新技術、新產品，從而保持技術創新性和產品競爭力。

如果公司不能對未來市場的發展趨勢進行準確的判斷，保持核心技術優勢並推出具有競爭力的新產品，而競爭對手推出的新技術、新產品滿足市場需要，則公司將逐漸喪失市場競爭力，對公司未來持續發展經營造成不利影響。

(2) 研發人才緊缺及流失的風險

集成電路設計企業具有技術密集的特點，研發人員是其保持技術發展和產品優勢的核心要素。隨著行業規模的不斷增長，集成電路設計企業對於核心技術人才的競爭日趨激烈。如果公司不能有效穩定公司核心技術團隊，提供有市場競爭力的待遇，並保持對新人才的引進和培養，那麼可能出現人才流失或緊缺的風險，將對公司的持續研發能力造成不利影響。

(3) 核心技術洩密風險

經過專業研發團隊多年的積累，公司在傳感器、信號鏈、電源與驅動、第三代功率半導體等五大領域形成了多項核心技術。公司與核心技術人員簽署了保密協議，並就核心技術形成的知識產權申請了專利、計算機軟件著作權、集成電路布圖設計等。鑒於公司尚有多項產品和技術正處於研發階段，生產過程中也需向供應商提供相關數據、芯片版圖，如果出現核心技術人員流失或供應商保管不當等情況，可能產生核心技術洩密或被他人盜用的風險。

3、經營風險

(1) 委外加工及供應商集中度較高的風險

報告期內，公司主要採用集成電路設計行業常用的Fabless模式，晶圓製造、芯片封裝和芯片測試均由委外廠商完成。受限於技術水平、資本規模等因素，全球範圍內符合公司技術、供貨量、代工成本等要求的晶圓和封裝測試供應商數量較少，公司晶圓製造、封裝測試的代工服務主要委託業內知名廠商進行，採購集中度較高。如果公司的主要供應商業務經營發生重大變化、產能受限或合作關係變化，可能導致供應商不能足量及時出貨，或導致公司採購成本增加，可能對公司盈利能力和經營業績產生不利影響。

(2) 經營規模擴大帶來的管理風險

隨著公司業務持續發展和募投項目的實施，公司的收入和資產規模會進一步擴大，產品種類也將增多，員工人數相應增加，這將對公司的經營管理、質量管控、資源整合、市場開拓、內部控制、財務規範等方面提出更高的要求。如果公司不能隨業務規模擴大及時優化及提升組織模式、管理制度和管理水平，將會一定程度上面臨經營規模擴大帶來的管理風險，進而對盈利能力造成不利影響。

(3) 經銷模式下帶來的經營風險

公司產品的銷售部分由經銷商渠道實現，儘管已與其簽訂協議，對其市場與銷售行為進行規範，但公司對其日常經營活動的控制能力有限，且無法完全保證其始終遵守協議約定及相關法律法規。

若經銷商發生不當行為，例如對終端客戶進行未經授權的虛假陳述、侵犯第三方知識產權，或在業務活動中存在商業賄賂等違法違規行為，均可能導致本公司面臨來自終端客戶或第三方的索賠及訴訟。無論相關訴求是否合理，應對此類糾紛均可能消耗公司較多的財務與管理資源，並對公司聲譽及正常經營造成不利影響。

4、財務風險

(1) 存貨跌價風險

隨著公司業務規模的不斷擴大，存貨規模隨之上升，如果未來市場需求發生變化或與公司預測情況差異較大，或者公司不能隨著存貨的增加優化庫存管理水平，則可能導致產品滯銷、存貨積壓，從而需要增加計提存貨跌價準備，對公司經營業績產生不利影響。

(2) 毛利率波動風險

報告期內，公司各類產品毛利率及綜合毛利率均存在一定程度的波動。公司產品毛利率水平主要受產品售價波動、產品結構變化等因素影響所致。如果未來出現公司不能保持技術優勢、市場競爭加劇等原因而導致銷售價格下降，或採購價格上升導致成本上升，可能導致毛利率下降，對公司的盈利能力帶來一定風險。

(3) 匯率波動風險

隨著公司全球多元化戰略的推進實施，以外幣結算的採購和銷售業務比重不斷上升。匯率的變動將影響以外幣計價的資產、負債及境外實體的價值，並間接引起公司一定期間收益或現金流量的變化。隨著匯率市場化改革的深入，人民幣與其他可兌換貨幣之間的匯率波動較大，存在外匯結算過程中的匯率波動風險。

(4) 商譽風險

公司財務報表中確認了較大金額的商譽。截至2025年12月31日，公司商譽賬面價值為人民幣545.5百萬元，主要係收購麥歌恩股權和投資萊斯能特所致。

根據企業會計準則，商譽需至少每年進行減值測試，其價值評估依賴於管理層對未來現金流、增長率和折現率等一系列關鍵參數的估計與判斷。如果未來宏觀經濟、市場環境、行業競爭或公司自身經營狀況發生重大不利變化，導致相關資產組的實際盈利能力或預測數據低於前述評估所依據的假設，則公司可能需對該等商譽計提大額減值準備。

商譽減值損失一經確認，在後續會計期間不予轉回，將直接減少當期利潤，並對公司的資產狀況、財務狀況和經營成果產生重大不利影響。

5、行業風險

公司主要產品的競爭對手為成立時間早、營收規模大且品牌影響力較高的國外龍頭企業，如德州儀器(TI)、亞德諾(ADI)、英飛凌(Infineon)、埃戈羅(Allegro)、邁來芯(Melexis)、瑞薩電子(Renesas)等公司。公司在營收規模、產品豐富度和技術積累上與上述公司仍有一定差距，如果未來公司不能保持在細分產品領域的技術和性價比優勢，不能及時推出在功能、性能、可靠性等方面更為契合市場需求的產品，則會在客戶開發過程中面臨更為激烈的競爭，存在被上述國外廠商利用其先發優勢擠壓公司市場份額的風險。

公司所處的半導體行業具有週期性波動特徵。受技術迭代、產品生命週期以及供需關係變化等多重因素影響，行業歷史上曾經歷多次週期性下行。衰退期通常表現為需求驟降、產品售價快速下跌、產能利用率不足、存貨水平及減值風險上升。此類宏觀因素超出公司可控範圍，可能導致公司難以快速調整庫存以適應需求變化，並對產品定價產生不利影響。若公司未能準確預測或有效應對行業波動，公司的經營與財務狀況可能受到負面影響。

6、宏觀環境風險

(1) 宏觀環境及行業風險

公司芯片產品應用領域非常廣泛，涵蓋了汽車電子、工業、光伏儲能、電機控制、通訊、家電、醫療、消費等眾多行業，因此公司業務發展不可避免會受宏觀經濟波動的影響。如果宏觀經濟形勢不及預期或公司下游細分市場出現較大不利變化，可能會對公司經營業績產生不利影響。

(2) 國際貿易摩擦風險

報告期內，公司終端客戶包括諸多境內外知名企業，如果國際貿易摩擦進一步加劇，可能導致公司重大客戶採購受到限制，進而影響到公司向其銷售各類產品，對公司的經營業績產生一定的不利影響。同時，報告期內公司的晶圓代工、封裝測試主要向國內外的頭部供應商採購，上述供應商可能受到國際貿易政策的影響，進而影響到其對公司晶圓、封裝測試的供應，從而對公司生產經營產生一定不利影響。

7、其他重大風險

股權激勵導致股份支付金額持續較大的風險。在公司的快速發展階段，為吸引和留住優秀人才，充分調動公司員工的積極性，公司設立了多個員工持股平台，進行了多次股權激勵，導致公司股份支付費用大幅增加。儘管股權激勵有助於穩定人員結構以及留住核心人才，但相關的股份支付費用將會對公司經營業績產生一定影響。

回購、贖回或出售本公司上市證券

截至2025年12月31日止年度，本公司在上海證券交易所購回合共733,956股A股並以庫存股份持有(「所購回股份」)，總代價為人民幣112,744,745元(不含佣金及其他費用)。進行回購乃旨在未來適宜時機全部用於員工持股計劃或股權激勵。所購回股份的詳情如下：

購回日期	所購回 股份數目	已付每股價格		總代價 人民幣元
		最高價 人民幣元	最低價 人民幣元	
2025年12月08日	344,547	157.5	153.9	53,742,811
2025年12月10日	201,477	153.5	148.9	30,670,543
2025年12月11日	187,932	151.8	149.3	28,331,391
總計	733,956			112,744,745

於上市日期，本公司持有118,216股A股庫存股份。於2025年12月購回A股股份後，本公司於2025年12月31日持有852,172股A股庫存股份。

除上文所披露者外，本公司及其任何附屬公司於報告期內並無回購、贖回或出售本公司任何上市證券(包括出售或轉讓任何庫存股份)。

發行股份

於2025年12月8日，公司發行19,068,400股H股股份並在香港聯交所主板掛牌上市，每股發行價格116.00港元。其後，公司於2026年1月2日超額配售發行1,026,600股H股股份，每股發行價格116.00港元。公司本次發行H股合計20,095,000股所得款項淨額(扣除因發行新股直接產生的發行費用後)為2,210.8百萬港元(約為人民幣2,010.1百萬元，每股可得淨額約為人民幣100.0元)。截至本公告日期，於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所披露的所得款項淨額擬定用途概無變動。有關所得款項用途明細的詳情，請參閱將適時刊發的2025年年度報告。

除上文所披露者外，公司於報告期內並無發行其他股份。

重大投資以及有關附屬公司及聯營公司的重大收購或出售

報告期內，本公司並無持有其他重大投資、亦無進行有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購或出售。

股息

董事會不建議就截至2025年12月31日止年度派付任何末期股息。截至2025年12月31日止年度，本公司概無派付或擬派股息(2024年：無)。

期後事項

於2026年1月，本公司在上海證券交易所購回521,686股A股，並以庫存股份持有。

除上文以及本公告「發行股份」一節所披露者外，自報告期末以來本公司並無其他重大期後事項。

審計委員會

審計委員會由本公司三名獨立非執行董事組成，即陳西嬋博士、王如偉先生及杜琳琳女士，由杜琳琳女士擔任審計委員會主席。審計委員會已與管理層檢討本集團所採用之會計原則及慣例，並討論財務報告事項包括審閱本集團截至2025年12月31日止年度之綜合年度財務報表，並討論有關風險管理、內部監控事項，並無異議。

核數師的工作範圍

本集團核數師畢馬威會計師事務所已同意初步公告所載有關本集團截至2025年12月31日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合損益及其他全面收益表及其相關附註的數字，與本集團本年度經審核綜合財務報表所載金額相符。畢馬威會計師事務所就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此畢馬威會計師事務所並未就初步公告發出任何核證。

企業管治常規

本公司致力達致高水平的企業管治標準。

董事會認為，高水平的企業管治標準對於為本集團提供一個以保障股東利益、提升企業價值、制定業務戰略和政策以及提高透明度的框架至關重要。

本公司已採納《香港上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》的守則條文作為本公司企業管治常規的基準。

由於本公司H股於2025年12月8日在香港聯交所上市，《企業管治守則》自H股上市日期起才適用於本公司。董事會認為，於上市日期至2025年12月31日期間，除下文所披露者外，本公司已遵守《企業管治守則》所載的所有適用守則條文。

根據《企業管治守則》的守則條文第C.2.1條，董事長與行政總裁的職責應有區分且不應由一人同時兼任。我們並無分立的董事長及總經理，王升楊先生現時履行上述兩項職務。董事會認為，鑒於其經驗、個人履歷及對業務營運的了解，王升楊先生為識別戰略機會的最適合董事，故由王升楊先生兼任董事長及總經理可促進戰略舉措的有效執行並有助於管理層與董事會之間的信息傳遞順暢。董事會認為，以同一人兼任董事長及總經理，有利於確保本集團內的貫徹領導，並能為本集團提供更有效力和效率的整體戰略規劃。此外，所有重大決定乃經諮詢董事會成員(包括相關董事委員會及獨立非執行董事)後作出。董事會認為，現有安排的權力及授權平衡不會受到損害，而該架構將使本公司能夠迅速有效地作出及實施決策。董事會將繼續檢討，並在考慮本集團整體情況後於適當時機，將本公司董事長與總經理之職務分開。

董事遵守進行證券交易的標準守則

本公司已採納《香港上市規則》附錄C3所載的《標準守則》作為董事進行證券交易的守則。

經向全體董事作出具體查詢後，董事均確認彼等於上市日期起至2025年12月31日止整個期間已遵守《標準守則》。

本公司已制定不遜於《標準守則》的《信息披露管理辦法》及《內幕信息及股票交易合規管理辦法》（統稱，「**信息披露管理規章**」），以供因職位或受僱而可能擁有關於本公司或其證券的內幕消息的僱員進行證券交易。由於本公司的H股於2025年12月8日在香港聯交所上市，故《標準守則》自H股上市日期起才適用於本公司。據董事所深知，自上市日期起至2025年12月31日止，並無知悉任何僱員違反信息披露管理規章的事件。

刊發年度業績及H股2025年年度報告

本業績公告於本公司網站(www.novosns.com)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)刊載。本公司截至2025年12月31日止年度的H股年報將適時於本公司網站及香港聯交所網站以供查閱，並將適時寄發予已表示希望收到印刷本的股東。

釋義

在本公告中，除非文意另有所指，下列詞語或詞組具有如下含義：

「A股」	指	每股面值人民幣1.00元的本公司內資股，於上海證券交易所上市並以人民幣交易
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「《企業管治守則》」	指	《香港上市規則》附錄C1《企業管治守則》
「中國」	指	中華人民共和國

「公司」、「本公司」或「我們」	指	蘇州納芯微電子股份有限公司，一間於2013年5月17日在中國成立的公司，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：688052)，其H股於香港聯交所主板上市(股份代號：2676)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「境內」或「國內」	指	中國大陸(僅就本公告而言，不包括香港、澳門和台灣地區)
「全球發售」	指	本公司提呈發售H股以供認購，其詳情載於招股章程
「集團」	或	「本集團」指本公司及併表範圍內的子公司(附屬公司)
「H股」	指	每股面值人民幣1.00元的本公司境外上市外資普通股，於香港聯交所上市並以港元交易
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「《香港上市規則》」	指	《香港聯交所證券上市規則》
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的標準、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋

「上市日期」	指	2025年12月8日，即本公司的H股在香港聯交所主板掛牌並上市交易的日期
「《標準守則》」	指	《香港上市規則》附錄C3《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「招股章程」	指	本公司日期為2025年11月28日有關全球發售的招股章程
「報告期」、「本年度」或「本期」	指	2025年1月1日至2025年12月31日
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「《證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》
「股份」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，包括A股和H股
「股東」	指	股份持有人
「同比」	指	與上年同期比較
「%」	指	百分比

技術詞彙表

於本公告內，除非文義另有所指，否則本文件所用有關本公司及其業務的若干詞彙的解釋及釋義具有下文所載涵義。該等詞彙及其涵義未必與該等詞彙的標準行業涵義或用法一致。

「ADC」	指	模擬數字轉換器，用於將連續的模擬信號轉換為離散的數字信號的裝置
「AEC-Q」	指	汽車電子委員會制定的標準
「模擬」	指	模擬信號，隨某一隨時間變化參數而連續且無限變化的電壓、電流或物理量
「車規級」	指	車規級芯片是指經過專門設計、製造及鑒定以滿足汽車行業嚴格要求及標準的芯片
「BMS」	指	電池管理系統
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「CAN」	指	控制器區域網絡，一種通訊協議
「CMOS」	指	互補式金屬氧化物半導體
「DAC」	指	數字模擬轉換器，用於將數字信號轉換為模擬信號的裝置
「DC」	指	直流電
「數字」	指	以離散數值序列表示數據的信號

「fabless」	指	實體專注於芯片研發與設計，並將製造外包給第三方的商業模式
「GaN」	指	氮化鎵，一種二元III/V族直接帶隙半導體，適用於高功率且可在高溫下運作的電晶體
「霍爾效應」	指	當磁場垂直於導體內電流時，在導體兩側產生電壓差的現象，為多種磁感測技術的基礎
「芯片」或「集成電路」	指	在一小片半導體材料(晶片)上的一組電子電路
「I ² C」	指	同步式多主控／多從屬單端串列通訊協議
「IGBT」	指	絕緣柵雙極型電晶體，三端功率半導體元件，主要作為電子開關
「LDO」	指	低壓差線性穩壓器，可在極小輸入輸出電壓差下運作的穩壓器
「LED」	指	發光二極體，通電時會發光的半導體二極體，廣泛應用於電子設備
「LIN」	指	用於現代車輛部件間通訊的網絡協議
「MCU」	指	微控制器單元，包含通用處理器核心、輸入／輸出接口及多功能模組的芯片
「MEMS」	指	微機電系統，由尺寸介於1至100微米元件構成的微型裝置技術
「MOSFET」	指	金屬氧化物半導體場效電晶體，用於放大或切換電子信號的電晶體類型
「運放」	指	接收差分電壓輸入並產生單端電壓輸出的模擬電路模組

「光伏」	指	光伏
「研發」	指	研究與開發
「傳感器」	指	測量或偵測現實世界狀況(如動作、熱力或光線)，並將狀況轉換為模擬或數字表示的裝置
「SiC」	指	碳化矽，一種用於多種電子應用的半導體材料
「V」	指	伏特，電壓單位
「VHS」	指	垂直霍爾傳感器，一種優化用於偵測垂直磁場的霍爾傳感器結構

承董事會命
蘇州納芯微電子股份有限公司
董事長兼執行董事
王升楊先生

香港，2026年3月30日

於本公告日期，董事包括：(i)執行董事王升楊先生、盛雲先生、王一峰先生及姜超尚先生；(ii)非執行董事吳傑先生；及(iii)獨立非執行董事洪志良博士、陳西嬋博士、王如偉先生及杜琳琳女士。